(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





(43) Date de la publication internationale 9 juin 2005 (09.06.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/051858 A1

- (51) Classification internationale des brevets7: C03C 17/36
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/050614

(22) Date de dépôt international:

24 novembre 2004 (24.11.2004)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

- (30) Données relatives à la priorité : 0313966 28 novembre 2003 (28.11.2003) FI
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE [FR/FR]; 18, avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): FLEURY, Carinne [FR/FR]; Saint-Gobain Recherche, 39, quai Lucien Lefranc, F-93303 Aubervilleirs (FR). BELLIOT, Sylvain [FR/FR]; Saint-Gobain Recherche, 39, quai Lucien Lefranc, F-93303 Aubervilleirs (FR). NADAUD, Nicolas [FR/FR]; Saint-Gobain Recherche, 39, quai Lucien Lefranc, F-93303 Aubervilleirs (FR).
- (74) Mandataire: SAINT-GOBAIN RECHERCHE; 39, quai Lucien Lefranc, F-93300 Aubervilleirs (FR).

- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

- (54) Title: TRANSPARENT SUBSTRATE WHICH CAN BE USED ALTERNATIVELY OR CUMULATIVELY FOR THERMAL CONTROL, ELECTROMAGNETIC ARMOUR AND HEATED GLAZING
- (54) Titre : SUBSTRAT TRANSPARENT UTILISABLE ALTERNATIVEMENT OU CUMULATIVEMENT POUR LE CONTROLE THERMIQUE, LE BLINDAGE ELECTROMAGNETIQUE ET LE VITRAGE CHAUFFANT.
- (57) Abstract: The invention relates to a transparent substrate which is made, for example, from glass and which is equipped with a stack of thin layers comprising a plurality of functional layers. The invention is characterised in that: (i) the aforementioned stack of thin layers comprises at least three silver-based functional layers, (ii) the stack has a per-square resistance of $R_{\square} < 1.5 \Omega$, and (iii) the substrate can be subjected to at least one processing operation involving a heat treatment at a temperature of at least 500 °C, such as to enable the substrate to be used alternatively or cumulatively to provide thermal control and/or electromagnetic armour and/or heated glazing.
 - (57) Abrégé: L'invention a pour objet un substrat transparent, notamment en verre, muni d'un empilement de couches minces comportant une pluralité de couches fonctionnelles, caractérisé en ce que ledit empilement de couches minces comporte au moins trois couches fonctionnelles à base d'argent, en ce que ledit empilement présente une résistance $R_{\square} < 1,5 \Omega$ par carré et en ce que ledit substrat peut subir au moins une opération de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C, afin de permettre de réaliser à l'aide du substrat alternativement ou cumulativement du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

VO 2005/051858 A

SUBSTRAT TRANSPARENT UTILISABLE ALTERNATIVEMENT OU CUMULATIVEMENT POUR LE CONTRÔLE THERMIQUE, LE BLINDAGE ELECTROMAGNETIQUE ET LE VITRAGE CHAUFFANT

5

10

15

20

25

30

La présente invention se rapporte au domaine des vitrages pouvant être utilisés alternativement ou cumulativement dans trois applications particulières : le contrôle thermique (antisolaire et isolation thermique), le blindage électromagnétique et le vitrage chauffant, tout en pouvant, de préférence, subir au moins une opération de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C (il peut notamment s'agir d'une trempe, d'un recuit ou d'un bombage).

Le contrôle thermique est la possibilité d'agir sur le rayonnement solaire et/ou le rayonnement infrarouge de grande longueur d'onde traversant un vitrage séparant un environnement extérieur d'un environnement intérieur, soit pour réfléchir le rayonnement solaire vers l'extérieur (vitrages « antisolaires » ou « de contrôle solaire »), soit pour réfléchir le rayonnement infrarouge de longueur d'onde supérieure à 5 μm vers l'intérieur (isolation thermique avec des vitrages appelés notamment « vitrages bas-émissifs »).

Le blindage électromagnétique est la possibilité d'annihiler, ou pour le moins de réduire, la propagation d'ondes électromagnétiques à travers un vitrage. Cette possibilité est souvent associée avec la possibilité d'agir sur le rayonnement infra-rouge traversant le vitrage. Cette application trouve un intérêt dans le domaine électronique, notamment pour la réalisation de fenêtres de blindage électromagnétique, encore appelées « filtres électromagnétiques », destinées par exemple à être disposées sur la face avant d'un écran de visualisation utilisant la technologie plasma.

Un vitrage chauffant est un vitrage dont la température peut s'élever lorsqu'il est soumis à un courant électrique. Ce type de vitrage trouve des applications dans l'automobile, voire dans le bâtiment, pour la réalisation de vitres qui permettent d'empêcher la formation, ou de supprimer, du givre ou de la buée, ou encore de supprimer la sensation de paroi froide à proximité du vitrage.

La présente invention se rapporte plus particulièrement un substrat transparent, notamment en verre, muni d'un empilement de couches minces comportant une

pluralité de couches fonctionnelles, ledit substrat pouvant être utilisé pour réaliser alternativement ou cumulativement du contrôle thermique, du blindage électromagnétique et du vitrage chauffant.

Il est connu de réaliser des empilements de couches minces pour opérer du contrôle thermique, et plus précisément du contrôle solaire, qui soient capables de conserver à la fois leurs propriétés thermiques et leurs propriétés optiques après traitement thermique, en minimisant toute apparition de défauts optiques; L'enjeu étant alors d'avoir ainsi des empilements de couches minces à performances optiques/thermiques fixes, qu'ils subissent ou non par la suite un ou des traitement(s) thermique(s).

5

10

15

20

25

30

Une première solution a été proposée dans la demande de brevet européen N° EP 718 250. Elle préconise d'utiliser au-dessus de la ou des couches fonctionnelles à base d'argent des couches-barrière à la diffusion de l'oxygène, notamment à base de nitrure de silicium, et de déposer directement les couches d'argent sur le revêtement diélectrique sous-jacent, sans interposition de couches de primage ou de couches métalliques de protection. Cette demande de brevet décrit notamment un empilement du type :

Substrat/Si₃N₄ ou AlN/ZnO/Ag/Nb/ZnO/Si₃N₄

Une seconde solution a été proposée dans la demande de brevet européen N° EP 847 965. Elle repose sur des empilements comprenant deux couches d'argent, et décrit l'utilisation à la fois d'une couche-barrière au-dessus des couches d'argent (comme précédemment) et d'une couche absorbante ou stabilisante, adjacente auxdites couches d'argent et permettant de les stabiliser.

Cette demande de brevet décrit notamment un empilement du type : Substrat/SnO₂/ZnO/Ag1/Nb/Si₃N₄/ZnO/Ag2/Nb/SnO₂/Si₃N₄

Dans les deux précédentes solutions, on remarque la présence de la couche métallique absorbante de « sur-bloqueur », en niobium en l'occurrence voire en titane, sur les couches d'argent, permettant d'éviter aux couches d'argent le contact avec une atmosphère réactive oxydante ou nitrurante lors du dépôt par pulvérisation réactive respectivement de la couche de SnO₂ ou de la couche de Si₃N₄.

Une troisième solution a depuis été divulguée dans la demande internationale de brevet N° WO 03/01105. Elle propose de déposer la couche métallique absorbante de « bloqueur » non pas sur la (ou chaque) couche fonctionnelle, mais dessous, afin de

permettre de stabiliser la couche fonctionnelle pendant le traitement thermique et améliorer la qualité optique de l'empilement après traitement thermique.

Cette demande de brevet décrit notamment un empilement du type :

Substrat/Si₃N₄/ZnO/Ti/Ag1/ZnO/Si₃N₄/ZnO/Ti/Ag2/ZnO/Si₃N₄

Toutefois, dans les plages d'épaisseurs divulguées, un tel empilement n'est pas utilisable pour réaliser un vitrage chauffant ou un vitrage de blindage électromagnétique présentant une esthétique (caractéristiques optiques) acceptable.

L'art antérieur connaît en outre des empilements de couches minces sur substrat qui peuvent être utilisés pour opérer du contrôle thermique et du vitrage chauffant lorsque soumis à un courant électrique. La demande internationale de brevet N° WO 01/14136 divulgue ainsi un empilement bi-couches d'argent supportant un traitement thermique de trempe, qui peut être utilisé pour opérer du contrôle solaire et pour produire de la chaleur lorsque soumis à une courant électrique. Toutefois, la résistivité de cet empilement ne permet pas vraiment de réaliser du blindage électromagnétique efficace car sa résistance par carré R_{\square} ne peut être proche et a fortiori inférieure à 1,5 ohm par carré.

De plus, pour l'application vitrage chauffant pour automobile, cette forte résistance par carré oblige à utiliser une batterie présentant une forte tension à ses bornes (de l'ordre de 42 Volts, standard disponible sur le marché) pour pouvoir opérer un chauffage sur toute la hauteur du vitrage. En effet, par application de la formule $P(W) = U^2/(R_{\square} \times h^2)$, si $R_{\square} = 1,5$ Ohm par carré, pour arriver à $P = 600 \text{ W/m}^2$ (puissance dissipée estimée pour chauffer correctement) et pour obtenir une hauteur de chauffage h > 0.8 mètre, il faut U > 24 Volts.

25

30

5

10

15

20

Il est également connu de réaliser des empilements de couches minces pour opérer du blindage électromagnétique à l'aide d'un substrat doté d'un empilement de protection électromagnétique présentant une bonne protection électromagnétique, et permettant à un utilisateur de visualiser facilement l'affichage des images grâce à une transmittance lumineuse élevée associée à une réflectance faible.

Pour réaliser du blindage électromagnétique, l'art antérieur connaît aussi de la demande internationale de brevet N°WO 01/81262 un empilement notamment du type :

 $Substrat/Si_3N_4/ZnO/Ag1/Ti/Si_3N_4/ZnO/Ag2/Ti/ZnO/Si_3N_4$

WO 2005/051858 PCT/FR2004/050614

Cet empilement peut supporter un traitement thermique de trempe ou de bombage. Toutefois, cet empilement ne permet pas d'obtenir une résistance par carré qui soit de beaucoup inférieure à 1,8 ohm par carré avec des caractéristiques optiques (T_L, R_L, couleur, ...) jugées acceptables et notamment une réflexion lumineuse dans le visible R_L, faible.

5

10

15

20

25

30

4

Les empilements à base de couche d'argent sont fabriqués dans des unités de fabrication très complexes.

L'inconvénient majeur de l'art antérieur réside dans le fait qu'il est impératif de procéder à des modifications majeures dans la ligne de production lorsque l'on souhaite utiliser la ligne de production pour fabriquer un empilement de couches minces sur substrat qui n'a pas la (ou les) même(s) application(s) que l'empilement précédemment fabriqué sur cette même ligne.

Cette opération dure en général plusieurs heures à plusieurs jours, est fastidieuse et engendre une perte d'argent très importante car on ne peut produire de vitrages pendant cette période de transition et de mise au point.

En particulier, dès lors que le matériau de la cible diffère d'une produit au suivant, il faut remettre la chambre à la pression atmosphérique avant de changer la cible, puis remettre la chambre sous vide (de l'ordre de 10⁻⁶ bar), ce qui est évidemment long et fastidieux.

Le but de l'invention est alors de pallier ces inconvénients en proposant un substrat muni d'un empilement de couches minces et un procédé de fabrication de ce substrat qui permettent d'obtenir un produit utilisable alternativement ou cumulativement pour réaliser du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

En particulier, le but de l'invention est de permettre de réaliser toute une gamme de produits sans avoir à ouvrir l'installation de dépôt pour changer de cible, afin de permettre d'économiser le temps nécessaire à la mise à l'atmosphère et surtout à la remise sous vide de l'installation après changement de cible.

La présente invention propose ainsi un empilement particulier, défini en terme de composition des différentes couches et d'épaisseur, qui peut être utilisé pour toutes ces applications à la fois, mais également un type d'empilement, défini en terme de composition des différentes couches, de plages d'épaisseur et/ou de caractéristiques optiques, dans lequel certaines valeurs d'épaisseur permettent de favoriser l'utilisation

10

15

20

25

30

pour une application donnée. Cet empilement est remarquable en ce qu'il présente une résistance par carré faible (résistance R_{\square} < 1,5, voire \leq 1,3 Ω par carré) tout en conservant sensiblement ses caractéristiques lorsqu'il est soumis à un traitement thermique du type bombage ou trempe.

Ainsi, grâce à ce type d'empilement selon l'invention, pour fabriquer des empilements destinés à une seule ou seulement deux ou les trois application(s) spécifique(s), certain(s) paramètre(s) peu(ven)t être changé(s), tel que l'épaisseur de certaines couches, mais la composition reste globalement identique. Quelques heures suffisent ainsi pour modifier la ligne de production et passer de la fabrication d'un produit ayant une ou plusieurs application(s) préférée(s) à un autre produit ayant une ou plusieurs autre(s) application(s) préférée(s).

La présente invention a ainsi pour objet un substrat transparent, notamment en verre, selon la revendication 1. Ce substrat est muni d'un empilement de couches minces comportant une pluralité de couches fonctionnelles, ledit empilement de couches minces comportant au moins trois couches fonctionnelles à base d'argent, ledit empilement présentant une résistance $R_{\square} < 1,5$, voire $\le 1,3$ Ω par carré et ledit substrat pouvant subir au moins une opération de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C, afin de permettre de réaliser à l'aide du substrat alternativement ou cumulativement du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

Par « ledit substrat peut subir au moins une opération de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C », on entend le fait que le traitement ne dégrade pas la qualité optique et n'engendre pas l'apparition de piqûres visibles à l'œil nu et/ou de flou en transmission lors de la réalisation d'un bombage, d'une trempe ou d'un recuit à une température d'au moins 500°C ou supérieure à 500°C.

Par ailleurs, la résistance R_\square revendiquée est, sauf indication contraire, mesurée avant cet éventuel traitement thermique.

Dans une première application pour la réalisation d'un vitrage automobile, le substrat selon l'invention présente une transmission lumineuse $T_L \ge 70$ % et une résistance $R_{\square} < 1.5$, voire ≤ 1.3 , voire mieux encore ≤ 1.2 Ω par carré.

Dans une deuxième application pour la réalisation d'un vitrage de bâtiment, le substrat transparent selon l'invention présente une transmission lumineuse $T_L \geq 40$ %,

voire ≥ 50 % avec de préférence une réflexion lumineuse dans le visible $R_L \leq 10$ %, voire ≤ 8 % et lorsqu'il est associé avec au moins un autre substrat pour former un vitrage, ce vitrage présente une sélectivité ≥ 2 , voire ≥ 2 .

Il est rappelé ici que la sélectivité est définie par le rapport entre la transmission lumineuse (T_L) et le facteur solaire (FS), soit par T_L / FS, le facteur solaire représentant la somme de la transmission énergétique directe (T_E) du vitrage et de l'énergie absorbée par le vitrage et ré-émise vers l'intérieur du bâtiment.

5

10

15

20

25

30...

Dans une troisième application pour la réalisation d'un vitrage de blindage électromagnétique, le substrat transparent selon l'invention présente une transmission lumineuse $T_L \ge 40$ %, voire ≥ 50 %, voire mieux encore ≥ 55 % et une résistance $R_{\square} \le 1,2$, voire ≤ 1 Ω par carré.

L'avantage majeur engendré par le fait que le substrat de blindage électromagnétique supporte un traitement thermique du type trempe ou autre est que ainsi, on peut utiliser un substrat plus léger. En outre, les expériences montrent qu'il est toujours plus pratique au niveau industriel d'utiliser un substrat revêtu d'un empilement qui supporte un traitement thermique plutôt que d'utiliser un substrat ayant subi un traitement thermique puis de déposer un empilement dessus.

Le substrat sur lequel est déposé l'empilement est, de préférence, en verre.

D'une manière habituelle, dans le cadre de la présente invention, l'empilement étant déposé sur le substrat, ce substrat réalise un niveau 0 et les couches déposées dessus réalisent des niveaux au-dessus que l'on peut numéroter dans un ordre croissant avec des nombres entiers pour les distinguer. Dans le présent document, la numérotation est uniquement utilisée pour distinguer les couches fonctionnelles et leur ordre de dépôt.

Par couche « supérieure » ou couche « inférieure », on entend une couche qui n'est pas forcément déposée respectivement strictement au-dessus ou en dessous de la couche fonctionnelle lors de la réalisation de l'empilement, une ou plusieurs couches pouvant être intercalées. Chaque couche fonctionnelle étant associée avec une ou plusieurs couche(s) déposée(s) en dessous ou au-dessus de la couche fonctionnelle dont la présence dans l'empilement se justifie par rapport à cette couche fonctionnelle, on peut dire que l'association couche fonctionnelle avec sa (ou ses) couche(s) sous-jacente(s) et/ou sus-jacente(s) réalise « un motif ».

Selon une variante de l'invention, le substrat comporte au moins quatre couches fonctionnelles à base d'argent.

L'épaisseur totale des couches fonctionnelles à base d'argent est, de préférence, supérieure ou égale à 25 nm. Cette épaisseur totale est, de préférence, comprise sensiblement entre 35 et 50 nm lorsque l'empilement comprend trois couches fonctionnelles et sensiblement entre 28 et 64 nm lorsque l'empilement comprend au moins quatre couches fonctionnelles. Dans une variante, la somme des épaisseurs des couches d'argent est inférieure à 54 nm.

5

10

15

20

25

Selon une variante de l'invention, le substrat comporte au moins trois motifs identiques de couches fonctionnelles, chaque couche fonctionnelle étant associée dans chaque motif fonctionnel à au moins une couche sous-jacente et/ou sus-jacente.

Selon une autre variante de l'invention, au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, est située entre au moins une couche diélectrique inférieure et une couche diélectrique supérieure, les dites couches diélectriques étant, de préférence, à base de ZnO, éventuellement dopé à l'aluminium.

Selon une variante de l'invention, au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, comporte une couche supérieure à base de Si₃N₄. AlN ou à base d'un mélange des deux.

Selon une variante de l'invention, le substrat est directement revêtu d'une couche à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux.

Selon une variante de l'invention, dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante supérieure (appelée « sur-bloqueur »), de préférence à base de Ti, est située entre la couche fonctionnelle à base d'argent et au moins une couche diélectrique supérieure.

Selon une autre variante de l'invention, dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante inférieure (appelée « sous-bloqueur »), de préférence à base de Ti, est située entre au moins une couche diélectrique inférieure et la couche fonctionnelle à base d'argent.

La couche métallique absorbante supérieure ou inférieure peut également être constituée d'un métal ou d'un alliage à base de nickel, chrome, niobium, zirconium, tantale, ou aluminium.

Selon une variante de l'invention, au moins un motif fonctionnel, et de préférence chaque motif fonctionnel, présente la structure suivante : ZnO/Ag/...ZnO/Si₃N₄ et de préférence la structure suivante : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄.

Selon cette variante, les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement tri-couches sont, de préférence :

ZnO / Ag /...ZnO / Si₃N₄ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄ 5 à 15/10 à 17/...5 à 15/25 à 65 nm... 5 à 15/10 à 17/ 0,2 à 3/5 à 15/25 à 65 nm ou 7 à 15/10 à 17/...7 à 15/25 à 65 nm... 7 à 15/10 à 17/ 0,2 à 2/7 à 15/25 à 65 nm.

Selon cette variante également, les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement quadri-couches sont, de préférence :

ZnO / Ag /...ZnO / Si₃N₄ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄ 5 à 15/7 à 15/...5 à 15/23 à 65 nm... 5 à 15/7 à 15/0,2 à 3/5 à 15/23 à 65 nm ou 7 à 15/7 à 15/...7 à 15/23 à 65, nm... 7 à 15/7 à 15/0,2 à 2/7 à 15/23 à 65 nm.

5

10

15

20

25

30

L'invention a également pour objet un procédé de fabrication d'un substrat transparent, notamment en verre, muni d'un empilement de couches minces comportant une pluralité de couches fonctionnelles, caractérisé en ce qu'au moins trois couches fonctionnelles à base d'argent sont déposées sur ledit substrat, en ce que ledit empilement présente une résistance $R_{\Box} < 1,5$, voire $\leq 1,3$ Ω par carré et en ce que ledit substrat peut subir au moins une opération de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C, afin de permettre de réaliser alternativement ou cumulativement à l'aide du substrat du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

Selon une variante de l'invention, au moins quatre couches fonctionnelles à base d'argent sont déposées sur ledit substrat.

L'épaisseur totale des couches fonctionnelles à base d'argent déposées est, de préférence, supérieure ou égale à 25 nm. Cette épaisseur totale est, de préférence, comprise sensiblement entre 35 et 50 nm lorsque l'empilement comprend trois couches fonctionnelles et sensiblement entre 28 et 64 nm lorsque l'empilement comprend au moins quatre couches fonctionnelles.

Selon une variante de l'invention, au moins trois motifs identiques de couches fonctionnelles sont déposés sur ledit substrat, chaque couche fonctionnelle étant associée dans chaque motif fonctionnel à au moins une couche sous-jacente et/ou sus-jacente.

Selon une variante de l'invention, pour au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, au moins une couche diélectrique inférieure est déposée sous ladite couche fonctionnelle et une couche diélectrique supérieure est déposée sur ladite couche fonctionnelle, lesdites couches diélectriques étant, de préférence, à base de ZnO, éventuellement dopé à l'aluminium.

10

15

20

25

30

Selon une variante de l'invention, une couche supérieure à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux est déposée au-dessus d'au moins une couche fonctionnelle, et de préférence au-dessus de chaque couche fonctionnelle.

Selon une variante de l'invention, ledit substrat est directement revêtu d'une couche à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux, déposée préalablement au dépôt de toutes les autres couches.

Selon une variante de l'invention, dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante supérieure, de préférence à base de Ti, est déposée au-dessus de la couche fonctionnelle à base d'argent et au-dessous d'au moins une couche diélectrique supérieure.

Selon une autre variante de l'invention, dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante inférieure, de préférence à base de Ti, est déposée au-dessus d'au moins une couche diélectrique inférieure et au-dessous de la couche fonctionnelle à base d'argent.

Selon une variante de l'invention, au moins un motif fonctionnel, et de préférence chaque motif fonctionnel, déposé présente la structure suivante : ZnO/Ag/...ZnO/Si₃N₄ et de préférence la structure suivante : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄.

Selon cette variante de l'invention, les épaisseurs des couches déposées constitutives dudit motif pour l'empilement tri-couches sont, de préférence :

ZnO / Ag /...ZnO / Si₃N₄ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄ 5 à 15/10 à 17/...5 à 15/25 à 65 nm... 5 à 15/10 à 17/ 0,2 à 3/5 à 15/25 à 65 nm ou 7 à 15/10 à 17/...7 à 15/25 à 65 nm... 7 à 15/10 à 17/ 0,2 à 2/7 à 15/25 à 65 nm.

Selon cette variante de l'invention également, les épaisseurs des couches déposées constitutives dudit motif pour l'empilement quadri-couches sont, de préférence :

ZnO / Ag /...ZnO / Si₃N₄ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄ 5 à 15/7 à 15/...5 à 15/23 à 65 nm... 5 à 15/7 à 15/ 0,2 à 3/5 à 15/23 à 65 nm ou 7 à 15/7 à 15/...7 à 15/23 à 65 nm... 7 à 15/7 à 15/ 0,2 à 2/7 à 15/23 à 65 nm.

Selon une variante de l'invention, le dépôt des motifs fonctionnels est opéré en passant plusieurs fois ledit substrat dans un dispositif unique de fabrication.

Selon cette variante de l'invention, lorsque ledit empilement comporte quatre couches fonctionnelles à base d'argent, le dépôt des motifs est, de préférence, opéré par paire en passant deux fois ledit substrat dans un dispositif unique de fabrication, selon

10

15

20

25

30

des conditions de dépôt sensiblement identiques pour les deux passages et de préférence, en conservant le substrat dans le vide entre les deux passages.

Selon cette variante de l'invention également, les épaisseurs des couches déposées sont, de préférence, sensiblement identiques lors de chacun des deux passages.

Par ailleurs, lorsque le substrat selon l'invention subit une opération de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C sa résistance R_{\square} est, de préférence, diminuée d'au moins 10 %, voire d'au moins 15 %.

L'invention a également pour objet un vitrage de contrôle thermique et/ou de blindage électromagnétique et/ou chauffant incorporant au moins un substrat selon l'invention.

L'invention a également pour objet l'utilisation du substrat selon l'invention pour réaliser alternativement ou cumulativement du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

Avantageusement, les économies réalisées par la mise en œuvre du procédé selon l'invention lors de la réalisation d'empilement selon l'invention sont énormes, car il n'est plus nécessaire d'arrêter la ligne de production pendant de longues journées ou au moins de longues heures lorsque l'on veut produire des empilements ayant une (ou plusieurs) application(s) différente(s). Quelques heures suffisent pour modifier les paramètres de production sur la ligne et obtenir un produit commercialisable ayant l'(ou les) application(s) souhaitée(s).

Avantageusement également, le substrat selon l'invention peut être utilisé pour réaliser des vitrages monolithiques, double ou triple vitrages, vitrages feuilletés, pour réaliser alternativement ou cumulativement du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

Ainsi, pour l'application automobile, il est possible de réaliser un vitrage feuilleté incorporant un substrat selon l'invention, ce vitrage réalisant à la fois :

- du contrôle thermique (et plus précisément du contrôle solaire pour réfléchir vers l'extérieur du véhicule le rayonnement solaire),
- du blindage électromagnétique pour protéger l'intérieur du véhicule du rayonnement électromagnétique extérieur et.
- du vitrage chauffant permettant de faire fondre du givre ou de vaporiser de la buée.

15

20

De même, pour l'application bâtiment, il est possible de réaliser un double vitrage incorporant un substrat selon l'invention, ce vitrage réalisant à la fois,

- du contrôle thermique (du contrôle solaire pour réfléchir vers l'extérieur de la pièce équipée du vitrage le rayonnement solaire et/ou de l'isolation thermique pour réfléchir vers l'intérieur de la pièce équipée du vitrage le rayonnement interne):
- du blindage électromagnétique pour protéger l'intérieur de la pièce équipée du vitrage du rayonnement électromagnétique extérieur, et
- du vitrage chauffant permettant de désembuer ou d'empêcher la formation de buée et d'empêcher la sensation de « paroi froide » à proximité du vitrage.

Avantageusement, ces vitrages incorporant un substrat selon l'invention présentent des couleurs en réflexion et en transmission esthétiquement acceptables.

La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description détaillée ci-après d'exemples de réalisation non limitatifs et des figures ci-jointes :

- La figure 1 illustre les valeurs de taux de réflexion lumineuse vers l'extérieur des exemples 11 et 13 en fonction de la longueur d'onde λ ;
- La figure 2 illustre les taux de transmission lumineuse, respectivement, de l'exemple 21 selon l'invention et de l'exemple comparatif 22 en fonction de la longueur d'onde λ , ainsi que la courbe de Parry-Moon de densité d'énergie solaire D en fonction de la longueur d'onde λ ;
- La figure 3 illustre les taux de transmission lumineuse, respectivement, de l'exemple 21 selon l'invention et de l'exemple comparatif 22 en fonction de la longueur d'onde λ , ainsi que la sensibilité de l'œil humain Y sur une échelle H normalisée ;
- La figure 4 illustre les taux de transmission lumineuse, respectivement, des exemples 23 et 24 selon l'invention et de l'exemple comparatif 25 en fonction de la longueur d'onde λ , ainsi que la courbe de Parry-Moon de densité d'énergie solaire D en fonction de la longueur d'onde λ ; et
- La figure 5 illustre un schéma d'assemblage d'un vitrage de blindage 30 électromagnétique mettant en œuvre le substrat selon l'invention.

10

15

20

25

30

1- Exemples d'empilements pour des vitrages chauffant et plus particulièrement pour des pare-brise alimentés en 12 V

La puissance dissipée pour chauffer correctement est estimée généralement à 600 W/m².

Or $P(W) = U^2/(R_{\square} \times h^2)$. Si U=12V, il faut $R_{\square} = 1$ Ohm par carré pour h = 50 cm; h correspondant à la hauteur de la « fenêtre » dans laquelle est réalisé le chauffage afin d'empêcher la formation de buée et/ou de givre (en pratique, la tension U est de 12 à 14 V, ce qui correspond à la tension aux bornes des batteries de la majorité des véhicules de locomotion actuellement produits; toutefois, cette tension pourrait être comprise entre 12 et 24 V).

Pour l'application automobile, un empilement présentant les caractéristiques suivantes (en feuilleté) peut être jugé satisfaisant :

- R_□ ≤ 1,2 Ohm par carré;
- Bonne qualité (pas de défauts perceptibles à l'œil nu) après bombage ;
- $T_L \ge 70\%$ et R_L limitée;
- Couleur en réflexion jugée esthétique (de préférence $a^* \le 0$ et $b^* \le 0$);
- durabilités mécanique et chimique satisfaisantes.

Les solutions à deux couches d'argent encapsulées dans des diélectriques ne permettent pas d'obtenir à la fois une $T_L \geq 70$ %, une résistance $R_{\square} \leq 1,2$ Ω par carré et une couleur acceptable.

Pour parvenir au résultat souhaité, il apparaît préférable :

- de positionner l'empilement de couches comportant les couches fonctionnelles en face 3 (la face 1 étant la face la plus à l'extérieur du véhicule et la face 4 étant la face la plus à l'intérieur); et
- de déposer plus de deux couches d'argent eu égard à l'épaisseur totale des couches d'argent nécessaire.

Des exemples de constitution d'empilements selon l'invention sont donnés ciaprès avec des empilements à trois couches fonctionnelles (exemples 11, 12 et 14) et à quatre couches fonctionnelles (exemples 15 et 16), les résultats ayant été mesurés après une opération de trempe à 620 °C pendant environ 8 min.

Exemple 11 selon l'invention, tri-couches:

Couches	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag1	ZnO	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag2	ZnO	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag3	ZnO	Si ₃ N ₄
Epaisseur	37	7	12,5	8	49	7	12,5	8	53	7	12,5	8	29
(nm)						į							

extérieur/verre (2,1mm)/PVB (0,76mm)/Ag3/Ag2/Ag1/verre (1,6mm)/habitacle

Exemple 12 selon l'invention, tri-couches: Même empilement que l'exemple

11 avec en outre un sur-bloqueur en titane au-dessus de chaque couche fonctionnelle
(épaisseur de l'ordre de 0,5 nm à 1 nm)

Exemple 13, exemple comparatif bi-couches:

Couches	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag1	ZnO	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag2	ZnO	Si ₃ N ₄
Epaisseur (nm)	24	8	8	6	70	8	7	6	26

extérieur/verre (2,1mm)/PVB (0,76mm)/Ag3/Ag2/Ag1/verre (1,6mm)/habitacle avec en outre un sous-bloqueur en titane au-dessous de chaque couche fonctionnelle (épaisseur de l'ordre de 0,5 nm à 1 nm)

Exemple 14 selon l'invention, tri-couches:

Couches	Si ₃ N ₄	ZnO	Agl	ZnO	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag2	ZnO	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag3	ZnO	Si ₃ N ₄
Epaisseur	37	7	12,5	8	52	7	13,5	8	52	7	14	8	31
(nm)							ĺ						

extérieur/verre (2,1mm)/PVB (0,76mm)/Ag3/Ag2/Ag1/verre (1,6mm)/habitacle

Caractéristiques techniques des vitrages feuilletés mesurées :

Exemple	R _□ (Ohm/□)	T _L (%)	T _E (%)	R _L (%) ext.	a*(Rext)	b*(Rext)	R _E (%)
11	1,09	70,4	30,4	12,1	-10,9	11,7	46,0
12	1,00	70,1	30,8	14,2	-9,3	7,9	46,1
13	4,60	76,1	46,1	17,8	-4,8	-1,9	29,8
14	1.00	70.5	31,4	11,5	-7,5	2,7	44,8

Exemple 15 selon l'invention, quadri-couches:

	THE PARTY OF THE P
SSN Z500 AV Z500 SON Z500 AV Z00 SSN Z00 SSN Z00 AV Z00 SSN Z00 AV Z	SYTHEORY
SYN ZHO AUT ZHO SIAN, ZHOLAG2 ZHO SIAN, ZHO AQ3 ZHO SYN ZHO AQ4 Z	317. I 311.0 x 3.4 E
30 8 7 7 57 8 7 8 7 8 7 50 8 75 7 50	<i>7</i> 7 . 12/22/3/61
[30 8 9 7 57 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8	
	and the second s

extérieur/verre (2,1mm)/PVB (0,76mm)/Ag3/Ag2/Ag1/verre (1,6mm)/habitacle

10

15

Exemple 16 selon l'invention, quadri-couches :

AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	general the france, her extensional transfer and approximation of the second
	NU ZHO A SE ZHIYI ÇÜNLÜ
Desire Complete	S
	-0
128 8 9 4 158 6 9 1 30 20 30 30	58 N W 128

extérieur/verre (2,1mm)/PVB (0,76mm)/Ag3/Ag2/Ag1/verre (1,6mm)/habitacle
Cet exemple 16 est obtenu par double passage du substrat dans une unité de

5 dépôt d'un empilement à deux couches d'argent.

Caractéristiques techniques des vitrages feuilletés mesurées :

Exemple	R_{\square}	T _L (%)	T _E (%)	R _L (%)	a*(Rext)	b*(Rext)	R _E (%)
	(Ohm/□)			ext.			
15	1,4	70,1	38,9	11,3	6,1	-9,9	31,8
16	1,03	70,3	31,7	8,3	-1,8	-2,5	40,4

La résistivité des empilements, calculée à partir de la résistance par carrée mesurée sans contact à l'aide d'un dispositif Nagy est de l'ordre de 4,2.10⁻⁶ Ohm.cm pour les exemples tri-couches selon l'invention 11 et 12, alors qu'elle est de l'ordre de 7,10⁻⁶ Ohm.cm pour l'exemple bi-couches comparatif 13.

Les exemples selon l'invention 11, 12, 14, 15 et 16 sont relativement stables en terme de T_L , R_L et couleur.

Les valeurs de réflexion énergétique sont très élevées, ce qui était attendu au regard de l'épaisseur cumulée d'argent ($3\times12,75$ nm). Une excellente sélectivité (T_L/FS proche, voire supérieure à 2 pour un échantillon feuilleté) a été obtenue.

La résistivité des couches d'argent inclues dans les empilements tri-couches comportant des couches d'argent présentant une épaisseur d'environ 13 nm est étonnamment basse par rapport aux valeurs obtenues avec un empilement bi-couches comportant des couches d'argent présentant une épaisseur d'environ 8 à 9 nm.

La qualité optique des quatre exemples selon l'invention après bombage est satisfaisante : il n'y a pas de flou ni de piqures de corrosion observable dans les conditions habituelles.

La durabilité chimique et mécanique de ces empilements selon l'invention est également très bonne.

10

15

20

25

WO 2005/051858 PCT/FR2004/050614

2- Exemples d'empilements pour des vitrages de contrôle thermique, particulièrement de contrôle solaire pour le bâtiment

Les performances d'un produit de contrôle solaire sont évaluées à partir du critère de « sélectivité », c'est à dire le rapport entre la transmission lumineuse du vitrage (T_L) et le pourcentage d'énergie solaire pénétrant à l'intérieur du bâtiment (Facteur Solaire – F.S.). Afin d'obtenir la plus importante sélectivité possible, tout en gardant un bon niveau de transmission lumineuse (nécessaire pour le confort des occupants des locaux), il est important de chercher à obtenir un vitrage qui assurera une coupure en transmission aussi abrupte que possible entre le domaine visible et le domaine infrarouge et ainsi éviter la transmission de l'énergie contenue dans cette partie du spectre (courbe Parry-Moon; PM). Le spectre idéal d'un vitrage de contrôle solaire est donc une fonction créneau assurant la transmission dans le visible et coupant totalement dans l'infrarouge.

La définition d'empilements tri-couches et quadri-couches d'argent selon l'invention permet d'augmenter cette sélectivité. En effet, pour des épaisseurs d'argent et de diélectrique bien choisies, le spectre en transmission d'un vitrage comportant ce type d'empilement se rapproche d'une fonction créneau et permet donc, à niveau de transmission égal, d'augmenter sensiblement la sélectivité. Ceci peut être obtenu sans perdre la neutralité en couleur des vitrages, aussi bien en transmission qu'en réflexion.

20

25

10

15

Des exemples de constitution d'empilements sont donnés ci-après avec des empilements à trois couches fonctionnelles (exemples 21 et 23) et à quatre couches fonctionnelles (exemple 24), comparés avec des empilements à deux couches fonctionnelles (exemples 22 et 25), respectivement pour obtenir un niveau transmission de 50 % (exemples 21 et 22), et un niveau transmission de 60 % (exemples 23 à 25) et une sélectivité optimisée.

Tous ces exemples ont été réalisés selon le schéma suivant :

extérieur/verre (6 mm)/empilement/espace(15 mm)/verre (6 mm)/intérieur,

avec un espace rempli d'argon à 90 % et 10 % d'air sec et les résultats donnés

ci-après ont été mesurés après une opération de trempe à 620 °C pendant environ 8 min.

Exemples 21 tri-couches selon l'invention et 22 bi-couches comparatif présentant chacun une transmission lumineuse de 50 % (épaisseurs des couches en nm):

Ex	Verre	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag1	ZnO	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag2	ZnO	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag3	ZnO	Si ₃ N ₄
21	6 mm	35	10	16,2	10	55	10	16,2	10	55	10	16,2	10	33
22	6 mm	26	10	9,2	10	63	10	19	10	20				

Une couche de sur-bloqueur en Ti d'environ 1 nm d'épaisseur a en outre été positionnée juste au-dessus de chaque couche fonctionnelle.

5

Caractéristiques techniques mesurées :

	T _L (%)	λ _d (nm)	p _e (%)	R _{int} (%)	L _{int} *	a _{int} *	b _{int} *	R _{ext} (%)	L _{ext} *	a _{ext} *	b _{ext} *	T _E (P.M. masse2)	T_L/T_E
Ex.21	50,2	501	6,6	12,7	42,3	-3,4	-3,1	13,8	43,9	-1,0	-1,3	20,0	2,51
Ex.22	49,3	514	3,3	23,0	55,1	0,7	5,9	19,2	50,9	-3,1	-9,2	24,2	2,04

La couleur dominante exprimée par λ_d et la pureté exprimée par p_e sont mesurées ici en transmission.

10

15

Exemples 23 tri-couches selon l'invention, 24 quadri-couches selon l'invention et 25 bi-couches comparatif présentant chacun une transmission lumineuse de 60 % (épaisseurs des couches en nm):

Īχ	SijNi	ZnO	ΔΩΙ	ZiiO	SigNa	ZiiC)	Ag2	Zuo	Si ₁ V.	ZiiO	Ags	7,10	SijNj	210	Ag4	7.nO	SigNa
23	30	15	11	15	50	15	14	15	50	415	14	15	30				
24	-24	15	12,5	15	52	15	12,5	115	52	- 15	12,5	115	52	15	12,5	15	24
28	25	10	9,5	15	52	-15	17	.,15	17								

Une couche de sur-bloqueur en Ti d'environ 1 nm d'épaisseur a en outre été positionnée juste sur chaque couche fonctionnelle.

Caractéristiques techniques mesurées :

							_ 1	٠,					
	T _L (%)	λ _d (nm)	p _e (%)	R _{int} (%)	L _{int} *	a _{int} *	b _{int} *	R _{ext} (%)	$L_{\rm ext}*$	a _{ext} *	b _{ext} *	T _E (P.M. masse2)	T_L/T_E
23	57,0	541	3,5	12,3	41,7	-0,9	-8,6	12,7	42,3	-2,6	-8,7	25,2	2,26
24	58,0	537	2,9	12,6	42,2	-6,6	0,7	12,2	41,5	-4,5	-1,7	24,8	2,34
25	60,1	515	3,2	19,0	50,7	2,1	1,3	15,7	46,6	-2,2	-9,8	29,5	2,04

Comme précédemment, la couleur dominante exprimée par λ_d et la pureté exprimée par p_e sont mesurées ici en transmission.

5

10

15

20

25

La comparaison des spectres des exemples selon l'invention 21, 23 et 24 avec les exemples comparatifs 22 et 25 sur l'ensemble du spectre solaire, illustrée figures 2 à 4, montre bien que les empilements tri-couches permettent de se rapprocher de la fonction créneau (pente très abrupte de la chute de transmission vers 780 nm (fin du domaine visible, début du domaine infrarouge). Il en va de même pour les empilements quadri-couches. Par ailleurs, cette augmentation de la sélectivité n'est pas obtenue au détriment de la colorimétrie du vitrage, la couleur en réflexion extérieure du vitrage étant neutre (dans le système L*a*b*) a* et b* étant négatifs et de faible valeur absolue. De plus, la couleur en transmission n'a pas une plus grande pureté, ce qui permet aux occupants des locaux d'apprécier l'environnement extérieur en vraies couleurs. Ce dernier point est observable sur la figure 3 montrant la superposition des spectres des exemples 21 et 22 et de la sensibilité de l'œil humain. En effet, ce graphique montre que le filtre optique réalisé à l'aide de l'empilement de couches minces de l'exemple 21 est plus large, en terme de longueur d'onde, que la distribution de la sensibilité de l'œil humain.

3- Exemples d'empilements pour des vitrages de blindage électromagnétique et plus particulièrement pour des écrans plasma

La structure de l'empilement réalisé pour vérifier l'intérêt de l'invention pour le blindage électromagnétique est la suivante :

substrat en verre clair (2mm)/empilement de couches minces présentant au moins trois couches fonctionnelles.

La trempe réalisée préalablement aux mesure a été provoquée par un recuit du substrat muni de l'empilement à une température d'environ 620 °C pendant 5 min.

10

15

Exemple 31 selon l'invention, quadri-couches:

The second secon	an improvement the control of the co
The state of the s	
- 1 C - 3 I - 7 C C 3 C C 2 C C 2 C C 2 C C C C C C C C	HAISONY I ZINDY I SANGELY NA HAISON ON DE LA SANGE
1	STEED STEEDING AND INDICATED THE TRANSPORT

avec en outre un sur-bloqueur en titane au-dessus de chaque couche fonctionnelle (épaisseur de l'ordre de 0,5 nm à 1nm)

Exemple 32 selon l'invention, quadri-couches:

H S. A. I Zhi, i P. A. C. I Zhi, J. Shi, I. Zhi, J. N. 22, Zhi, J. Shi, J. Zhi, J. P. G. A. J. P. B. A. L. G. Shi, J. P. S. P. L. P. S. P.
[10] [10] [14] [14] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15

avec en outre un sur-bloqueur en titane au-dessus de chaque couche fonctionnelle (épaisseur de l'ordre de 0,5 nm à 1 nm)

Exemple 33 selon l'invention, quadri-couches:

[29/21 XUO] VEH XHO [29/01 XHO] WES [29/01 DOM: [4-0] VEH XUS [49/24] AND [4-0] AND [4-0]
47 15 to 15 97

avec en outre un sur-bloqueur en titane au-dessus de chaque couche fonctionnelle (épaisseur de l'ordre de 0,5 nm à 1 nm)

Caractéristiques techniques mesurées après recuit :

Exemple	R_{\square} (Ohm/ \square)	résistivité	T _L (%)	R _L (%)	λ_d	pe (%)
_	_ ` _ ′	$(10^{-6}\Omega.\text{cm})$			(nm)	
31	0.9	4,5	72	6	490	9
32	0.7	3,9	70	10	450	5
33	1,2	4,8	72	7	520	5

La couleur dominante exprimée par λ_d et la pureté exprimée par p_e sont mesurées ici en réflexion.

20

25

Il apparaît que la trempe entraîne une baisse de la résistivité de l'argent et entraîne une modification très limitée des propriétés optiques de l'empilement. En effet, pour l'exemple 31, la résistance de cet empilement avant recuit était $R_{\square} = 1,1\Omega/\square$ (pour une résistivité de 5,5.10⁻⁶ Ohm.cm) soit une diminution d'environ 18 %, pour l'exemple 32, la résistance de cet empilement avant recuit était $R_{\square}=0,9\Omega/\square$ (pour une résistivité de 5,0.10⁻⁶ Ohm.cm) soit une diminution d'environ 22 % et pour l'exemple 33, la résistance de cet empilement avant recuit était $R_{\square}=1,5\Omega/\square$ soit une diminution

WO 2005/051858 PCT/FR2004/050614

19

d'environ 20 %. Toutefois, la trempe n'entraîne pas de modification majeure de la couleur.

L'empilement selon l'invention peut être utilisé dans un assemblage présentant par exemple la structure illustrée figure 5, afin de réaliser un filtre électromagnétique pour un écran utilisant la technologie plasma. Cet assemblage comporte :

- 1- Une couche anti-reflet optionnelle;
- 2- Un substrat en verre clair, qui pourrait également être teinté;
- 3- Un empilement de couches minces présentant au moins trois couches fonctionnelles;
- 4- Une feuille de matière plastique en PVB, qui pourrait également être en PSA optionnelle ;
- 5- Un film PET optionnel.

10

L'empilement de couches minces est ainsi positionné en face deux de 15 l'assemblage.

Le substrat recevant l'empilement peut être trempé après le dépôt de l'empilement.

La présente invention est décrite dans ce qui précède à titre d'exemple. Il est 20 entendu que l'homme du métier est à même de réaliser différentes variantes de l'invention sans pour autant sortir du cadre du brevet tel que défini par les revendications.

WO 2005/051858 PCT/FR2004/050614

20 REVENDICATIONS

1. Substrat transparent, notamment en verre, muni d'un empilement de couches minces comportant une pluralité de couches fonctionnelles, caractérisé en ce que ledit empilement de couches minces comporte au moins trois couches fonctionnelles à base d'argent, en ce que ledit empilement présente une résistance R_{\square} < 1,5 Ω par carré et en ce que ledit substrat peut subir au moins une opération de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C.

5

15

20

25

30

- 2. Substrat transparent selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente une transmission lumineuse $T_L \ge 70$ %.
 - 3. Substrat transparent selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente une transmission lumineuse $T_L \ge 40$ % et en ce que lorsqu'il est associé avec au moins un autre substrat pour former un vitrage, ce vitrage présente une sélectivité \ge 2.
 - 4. Substrat transparent selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente une transmission lumineuse $T_L \ge 40$ % et une résistance $R_{\square} \le 1,1$ Ω par carré.
 - 5. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte au moins quatre couches fonctionnelles à base d'argent.
 - 6. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'épaisseur totale des couches fonctionnelles à base d'argent est supérieure ou égale à 25 nm et est de préférence comprise entre 35 et 50 nm lorsque l'empilement comprend trois couches fonctionnelles et entre 28 et 64 nm lorsque l'empilement comprend au moins quatre couches fonctionnelles.
 - 7. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte au moins trois motifs identiques de couches fonctionnelles, chaque couche fonctionnelle étant associée dans chaque motif fonctionnel à au moins une couche sous-jacente et/ou sus-jacente.
 - 8. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, est située entre au moins une couche diélectrique

inférieure et une couche diélectrique supérieure, les dites couches diélectriques étant, de préférence, à base de ZnO, éventuellement dopé à l'aluminium.

9. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, comporte une couche supérieure à base de Si_3N_4 , AlN ou à base d'un mélange des deux.

5

10

15

20

30

- 10. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est directement revêtu d'une couche à base de Si₃N₄. AlN ou à base d'un mélange des deux.
- 11. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante supérieure, de préférence à base de Ti, est située entre la couche fonctionnelle à base d'argent et au moins une couche diélectrique supérieure.
- 12. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante inférieure, de préférence à base de Ti, est située entre au moins une couche diélectrique inférieure et la couche fonctionnelle à base d'argent.
- 13. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins un motif fonctionnel, et de préférence chaque motif fonctionnel, présente la structure suivante : ZnO/Ag/...ZnO/Si₃N₄ et de préférence la structure suivante : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄.
- 14. Substrat transparent selon la revendication précédente, caractérisé en ce 25 que les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement tri-couches sont :

ZnO / Ag /...ZnO / Si₃N₄ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄ 5 à 15/10 à 17/...5 à 15/25 à 65 nm... 5 à 15/10 à 17/ 0,2 à 3/5 à 15/25 à 65 nm.

15. Substrat transparent selon la revendication 13, caractérisé en ce que les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement quadri-couches sont :

ZnO / Ag /...ZnO / Si₃N₄ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄ 5 à 15/7 à 15/...5 à 15/23 à 65 nm... 5 à 15/7 à 15/0,2 à 3/5 à 15/23 à 65 nm. 16. Procédé de fabrication d'un substrat transparent, notamment en verre, muni d'un empilement de couches minces comportant une pluralité de couches fonctionnelles, caractérisé en ce qu'au moins trois couches fonctionnelles à base d'argent sont déposées sur ledit substrat, en ce que ledit empilement présente une résistance $R_{\square} < 1,5~\Omega$ par carré et en ce que ledit substrat peut subir au moins une opération de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C.

5

10

15

20

25

30

- 17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce qu'au moins quatre couches fonctionnelles à base d'argent sont déposées sur ledit substrat.
- 18. Procédé selon la revendication 16 ou la revendication 17, caractérisé en ce que l'épaisseur totale des couches fonctionnelles à base d'argent déposées est supérieure ou égale à 25 nm et est de préférence comprise entre 35 et 50 nm lorsque l'empilement comprend trois couches fonctionnelles et entre 28 et 64 nm lorsque l'empilement comprend au moins quatre couches fonctionnelles.
- 19. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 18, caractérisé en ce qu'au moins trois motifs identiques de couches fonctionnelles sont déposés sur ledit substrat, chaque couche fonctionnelle étant associée dans chaque motif fonctionnel à au moins une couche sous-jacente et/ou sus-jacente.
- 20. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 19, caractérisé en ce que pour au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, au moins une couche diélectrique inférieure est déposée sous ladite couche fonctionnelle et une couche diélectrique supérieure est déposée sur ladite couche fonctionnelle, lesdites couches diélectriques étant, de préférence, à base de ZnO, éventuellement dopé à l'aluminium.
- 21. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 20, caractérisé en ce qu'une couche supérieure à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux est déposée au-dessus d'au moins une couche fonctionnelle, et de préférence au-dessus de chaque couche fonctionnelle.
- 22. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 21, caractérisé en ce que ledit substrat est directement revêtu d'une couche à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux.
- 23. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 22, caractérisé en ce que dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante supérieure, de préférence à base de Ti,

est déposée au-dessus de la couche fonctionnelle à base d'argent et au-dessous d'au moins une couche diélectrique supérieure.

24. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 22, caractérisé en ce que dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante inférieure, de préférence à base de Ti, est déposée au-dessus d'au moins une couche diélectrique inférieure et au-dessous de la couche fonctionnelle à base d'argent.

5

10

20

25

- 25. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 24, caractérisé en ce qu'au moins un motif fonctionnel, et de préférence chaque motif fonctionnel, déposé présente la structure suivante : ZnO/Ag/...ZnO/Si₃N₄ et de préférence la structure suivante : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄.
- 26. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement tri-couches sont : $ZnO \ / \ Ag \ / ... ZnO \ / \ Si_3N_4 \ et \ de \ préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si_3N_4$
- 15 5 à 15/10 à 17/...5 à 15/25 à 65 nm... 5 à 15/10 à 17/0,2 à 3/5 à 15/25 à 65 nm.
 - 27. Procédé selon la revendication 25, caractérisé en ce que les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement quadri-couches sont : ZnO / Ag /...ZnO / Si₃N₄ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄ 5 à 15/7 à 15/...5 à 15/23 à 65 nm... 5 à 15/7 à 15/0,2 à 3/5 à 15/23 à 65 nm.
 - 28. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 27, caractérisé en ce que le dépôt des motifs fonctionnels est opéré en passant plusieurs fois ledit substrat dans un dispositif unique de fabrication.
 - 29. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que lorsque ledit empilement comporte quatre couches fonctionnelles à base d'argent, le dépôt des motifs est opéré par paire en passant deux fois ledit substrat dans un dispositif unique de fabrication.
 - 30. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les épaisseurs des couches déposées sont sensiblement identiques lors de chacun des deux passages.
- 31. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 30, caractérisé en ce que lorsque ledit substrat subit une opération de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C sa résistance R□ est diminuée d'au moins 10 %, voire d'au moins 15 %.

- 32. Vitrage de contrôle thermique et/ou de blindage électromagnétique et/ou chauffant incorporant au moins un substrat selon l'une quelconque des revendications 1 à 15.
- 33. Utilisation du substrat selon l'une quelconque des revendications 1 à 15,
 5 pour réaliser alternativement ou cumulativement du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

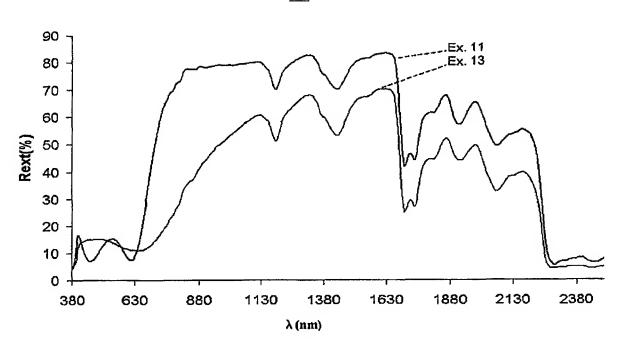


Fig. 1

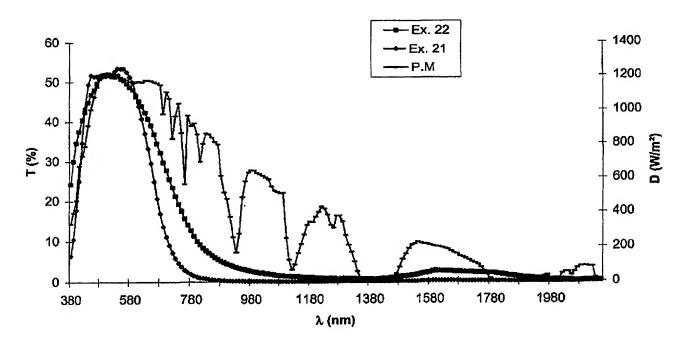


Fig. 2

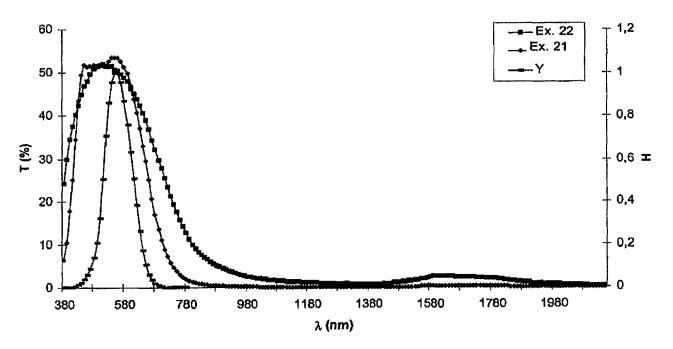


Fig. 3

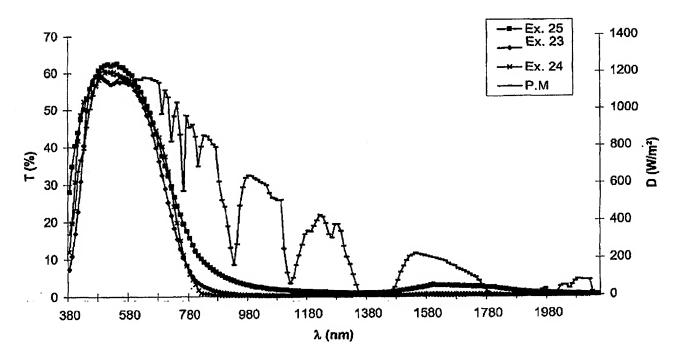


Fig. 4

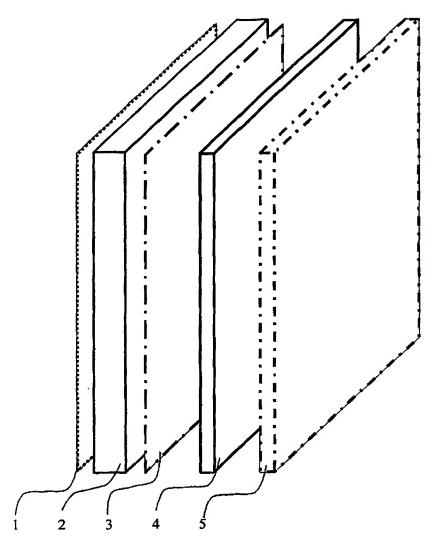


Fig. 5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inters nal Application No PCT/FR2004/050614

A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER C03C17/36									
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classification	ation and IPC								
B. FIELDS SEARCHED										
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed by classification COSC	on symbols)								
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are included in the fields se	arched							
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data bas	se and, where practical, search terms used	<u> </u>							
EPO-In	ternal									
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT									
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rek	evant passages	Relevant to claim No							
		0470	1.4.6.0							
X	WO 03/037056 A (OHNISHI TADASHI ; KEIJI (JP); TANAKA KATSUTO (JP);		1-4,6-9, 11,							
	YASUTAKA) 1 May 2003 (2003-05-01)		16-20,							
	•		23,24,							
	abstract; figures; tables		28-33							
	and the file and the									
X	US 6 353 501 B1 (WOODRUFF DANIEL	P ET AL)	1–33							
	5 March 2002 (2002-03-05) column 7, line 1 - line 47									
	column 9, line 38 - line 43; clai	ms 1,6,12								
l.,			1-33							
X	US 6 592 996 B1 (KUNISADA TERUFUS 15 July 2003 (2003-07-15)	SA ELAL)	1-33							
	column 12, line 4 - line 20; tabl	e 1								
Ì		-/								
ļ		′								
X Furti	her documents are listed in the continuation of box C	Patent family members are listed i	n annex.							
° Special ca	negories of cited documents.	"T" later document published after the Inte								
	ent defining the general state of the art which is not lered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention	eory underlying the							
	document but published on or after the international	"X" document of particular relevance, the c cannot be considered novel or cannot	laimed Invention							
'L' docume	and which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step when the do	cument is taken alone							
citatio	n or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the c cannot be considered to involve an in- document is combined with one or mo	entive step when the							
other i	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	ments, such combination being obvior in the art	us to a person skilled							
	ent published prior to the international filling date but an the priority date claimed	'&' document member of the same patent	family							
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	rch report							
2	May 2005	12/05/2005								
	mailing address of the ISA	Authorized officer								
	European Patent Office, P B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk									
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016									

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter onal Application No
PCT/FR2004/050614

	Dolovent to claim No
Criation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
US 2002/086164 A1 (OGINO ETSUO ET AL) 4 July 2002 (2002-07-04) claims; tables	1-33
US 5 595 825 A (GUISELIN OLIVIER) 21 January 1997 (1997-01-21) column 4, line 40 - line 54; table 1	1-33
US 6 007 901 A (MASCHWITZ PETER ET AL) 28 December 1999 (1999-12-28) column 3, line 66 - column 4, line 10 column 7, line 12 - column 8, line 16; claims 1,31	1-33
DE 197 51 711 A (LEYBOLD SYSTEMS GMBH) 27 May 1999 (1999-05-27) page 4, line 25 - line 40; figure 13	1-33
	4 July 2002 (2002-07-04) claims; tables US 5 595 825 A (GUISELIN OLIVIER) 21 January 1997 (1997-01-21) column 4, line 40 - line 54; table 1 US 6 007 901 A (MASCHWITZ PETER ET AL) 28 December 1999 (1999-12-28) column 3, line 66 - column 4, line 10 column 7, line 12 - column 8, line 16; claims 1,31 DE 197 51 711 A (LEYBOLD SYSTEMS GMBH) 27 May 1999 (1999-05-27)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Inter nal Application No PCT/FR2004/050614

	atent document d in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO	03037056	A	01-05-2003	JP JP WO	2003133787 2004128220 03037056	Α	09-05-2003 22-04-2004 01-05-2003
US	6353501	В1	05-03-2002	AU CZ EP JP WO US	2855000 20012666 1144908 2002535713 0043711 6490091 2002075203	A3 A1 T A1 B1	07-08-2000 17-04-2002 17-10-2001 22-10-2002 27-07-2000 03-12-2002 20-06-2002
US	6592996	B1	15-07-2003	JP JP CA DE DE EP HK US EP	11228185 2000302486 2261080 69907774 69907774 0934913 1021363 6413643 1044934	A A1 D1 T2 A1 A1 B1	24-08-1999 31-10-2000 06-08-1999 18-06-2003 24-12-2003 11-08-1999 21-01-2004 02-07-2002 18-10-2000
US	2002086164	A1	04-07-2002	JP CN EP	2000294980 1269699 1043606	Α	20-10-2000 11-10-2000 11-10-2000
US	5595825	Α	21-01-1997	FR AT CA DE DE DK EP ES JP	2710333 167464 2132254 69411107 69411107 645352 0645352 2119110 7149545	T A1 D1 T2 T3 A1 T3	31-03-1995 15-07-1998 24-03-1995 23-07-1998 11-03-1999 06-04-1999 29-03-1995 01-10-1998 13-06-1995
US	6007901	A	28-12-1999	DE DE EP WO	69804592 69804592 0960077 9928258	T2 A1	08-05-2002 07-11-2002 01-12-1999 10-06-1999
	19751711	Α	27-05-1999	DE	19751711		27-05-1999

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Dema Internationale No PCT/FR2004/050614

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 C03C17/36

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) C1B 7 C03C

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no des revendications visées
Х	WO 03/037056 A (OHNISHI TADASHI ; SATO KEIJI (JP); TANAKA KATSUTO (JP); TSUDA YASUTAKA) 1 mai 2003 (2003-05-01)	1-4,6-9, 11, 16-20, 23,24, 28-33
	abrégé; figures; tableaux	
X	US 6 353 501 B1 (WOODRUFF DANIEL P ET AL) 5 mars 2002 (2002-03-05) colonne 7, ligne 1 - ligne 47 colonne 9, ligne 38 - ligne 43; revendications 1,6,12	1-33
X	US 6 592 996 B1 (KUNISADA TERUFUSA ET AL) 15 juillet 2003 (2003-07-15) colonne 12, ligne 4 - ligne 20; tableau 1	1-33

Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
 T document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais crié pour comprendre le principe ou la théorie consitiuant la base de l'invention *X* document particulièrement pertinent; l'invent ion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré solément *Y* document particulièrement pertinent; l'invent ion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier *&* document qui fait partie de la même famille de brevets
12/05/2005
Fonctionnaire autonsé Reedijk, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Dem Internationale No
PCT/FR2004/050614

		PC1/FR2004/050614
	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages	pertinents no des revendications visées
Α	US 2002/086164 A1 (OGINO ETSUO ET AL) 4 juillet 2002 (2002-07-04) revendications; tableaux	1-33
A	US 5 595 825 A (GUISELIN OLIVIER) 21 janvier 1997 (1997-01-21) colonne 4, ligne 40 - ligne 54; tableau 1	1-33
A	US 6 007 901 A (MASCHWITZ PETER ET AL) 28 décembre 1999 (1999-12-28) colonne 3, ligne 66 - colonne 4, ligne 10 colonne 7, ligne 12 - colonne 8, ligne 16; revendications 1,31	1-33
A	DE 197 51 711 A (LEYBOLD SYSTEMS GMBH) 27 mai 1999 (1999-05-27) page 4, ligne 25 - ligne 40; figure 13	1-33

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Renseignements relatifs & membres de familles de brevets

Dem Internationale No
PCT/FR2004/050614

	brevet cité le recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
WO 030	37056	A	01-05-2003	JP JP WO	2003133787 2004128220 03037056	Α	09-05-2003 22-04-2004 01-05-2003
US 635	3501	B1	05-03-2002	AU CZ EP JP WO US	2855000 20012666 1144908 2002535713 0043711 6490091 2002075203	A3 A1 T A1 B1	07-08-2000 17-04-2002 17-10-2001 22-10-2002 27-07-2000 03-12-2002 20-06-2002
US 659	2996	B1	15-07-2003	JP JP CA DE DE EP HK US EP	11228185 2000302486 2261080 69907774 69907774 0934913 1021363 6413643 1044934	A1 D1 T2 A1 A1 B1	24-08-1999 31-10-2000 06-08-1999 18-06-2003 24-12-2003 11-08-1999 21-01-2004 02-07-2002 18-10-2000
US 200	2086164	A1	04-07-2002	JP CN EP	2000294980 1269699 1043606	Α	20-10-2000 11-10-2000 11-10-2000
US 559	5825	A	21-01-1997	FR AT CA DE DE DK EP ES JP	2710333 167464 2132254 69411107 69411107 645352 0645352 2119110 7149545	T A1 D1 T2 T3 A1 T3	31-03-1995 15-07-1998 24-03-1995 23-07-1998 11-03-1999 06-04-1999 29-03-1995 01-10-1998 13-06-1995
US 600	7901	A	28-12 - 1999	DE DE EP WO	69804592 69804592 0960077 9928258	T2 A1	08-05-2002 07-11-2002 01-12-1999 10-06-1999
DE 107	'51711	 A	27 - 05-1999	DE	19751711	A1	27-05-1999



REC'D **0 7 FEB 2005**WIPO PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le <u>9 4 JAN. 2005</u>

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1. a) OU b)

Martine PLANCHE

INSTITUT NATIONAL DE

LA PROPRIETE Industrielle SIEGE 26 bis, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08

Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécople : 33 (0)1 53 04 45 23

L L E www.inpl.fr

ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL

CREE PAR LA LOI Nº 51-444 DU 19 AVRIL 1951



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété Intellectuelle - Livre VI

ANTIGNAL DE LA PROPRIETE 1 NOUVERTEELE 26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

	Réservé à l'INPI		Cet imprimé est à remp	olir lisiblement à l'encre noire	D8 540 @ ₩ / 2109
REMISE DES PIÈCES		3		E DU DEMANDEUR OU DU MAN	
DATE	28 NOV. 200		A QUI LA CORI	RESPONDANCE DOIT ÊTRE ADR	ESSEE.
LIEU	INPI PARIS	ĥ.			
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'	0313966		SAINT-GOBAIN 39, quai Lucien I		
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE			F-93300 AUBER		
PAR LINDI	2 8 NOV. ₂	003	FRANCE		
Vos références po	ur ce dossier				=
(facultatif)	VJ2 2003103 FR				
Confirmation d'un	dépôt par télécopie	N° attribué par	l'INPI à la télécopie	03 13966	
2 NATURE DE L	A DEMANDE	Cochez l'une des	4 cases suivantes	and a supplied of the find of the supplied of	*
Demande de bi	revet	X			
Demande de ce	ertificat d'utilité				
Demande divisi	onnaire				
	Demande de brevet initiale	N°		Date	١
ou deman	de de certificat d'utilité initiale	N°		Date	
	d'une demande de			1 1	
	n Demande de brevet initiale IVENTION (200 caractères ou	N°		Date LILILI	<u> </u>
		I 7			
4 DÉCLARATIO		Pays ou organisation	on	N°	
•	DU BÉNÉFICE DE	Pays ou organisation	on		
LA DATE DE I	ÉPÔT D'UNE	Date		N°	
DEMANDE AN	ITÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation	on	N°	
		☐ S'il y a d'a	utres priorités, coche	z la case et utilisez l'imprimé	«Suite»
5 DEMANDEUR	(Cochez l'une des 2 cases)	X Personne r	norale	Personne physique	to a specific of the specific of the state of the specific of
Nom ou dénomination	on sociale	SAINT-GOBAIN	GLASS FRANCE		
Prénoms					
Forme juridique	3	S.A.			
N° SIREN		19191812161912	2,1,1		
Code APE-NAF					
Domicile	Rue	"Les Miroirs" 18	Avenue d'Alsace		
ou siège	Code postal et ville	[912141010] CC	URBEVOIE		
	Pays	FRANCE			
Nationalité		FRANCAISE			
N° de téléphon			N° de télécor	oie (facultatif)	
Adresse électro	onique (facultatif)			I am a salina Pinaniani	Culto-
		S'il y a plus d	un demandeur, coche	ez la case et utilisez l'imprimé	: «Suite»



Réservé à l'INPI

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2

BR2

DATE	DE DES FIELES	28 NOV. 200	3		
LIEU		INPI PARIS	F		
	ENREGISTREMENT ONAL ATTRIBUÉ PAR L	0313966	1		OB 540 W / 210502
6	MANDATAIRE	(sily alleu)		C. C. Self Co. Section 1	de la companya de la La companya de la co
	Nom		SAINT-GOBAIN	RECHERCHE	
	Prénom				
	Cabinet ou Soc	ciété			
	N °de pouvoir de lien contrac	permanent et/ou ctuel	422-5/S.006		
	Asturana	Rue	39, quai Lucien L		
	Adresse	Code postal et ville	19 13 13 10 10 1 AU	BERVILLIERS	
		Pays	FRANCE		
	N° de téléphor		33 1 48 39 59 60		
	N° de télécopi		33 1 48 34 66 96	<u> </u>	
	Adresse électro	onique (facultatif)		and the second s	The second section of the section of th
7	INVENTEUR	(S)	Les inventeurs so	ont nécessairement des	personnes physiques
	Les demandeu sont les même	urs et les inventeurs es personnes	Oui Non: Dans	ce cas remplir le formul	aire de Désignation d'inventeur(s)
8	RAPPORT DE	RECHERCHE	Uniquement pour	r une demande de breve	t (y compris division et transformation)
-	1110	Établissement immédiat ou établissement différé			
		elonné de la redevance (en deux versements)	Uniquement pour Oui Non	les personnes physiques	effectuant elles-mêmes leur propre dépôt
9	RÉDUCTION DES REDEVA		Requise pour la Obtenue antéri	er les personnes physique la première fois pour cette lieurement à ce dépôt pour lon à l'assistance gratuile ou p	invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> cette invention <i>(joindre une copie de la</i>
10	SÉQUENCES ET/OU D'ACI	DE NUCLEOTIDES IDES AMINÉS	Cochez la case	e si la description contient (une liste de séquences
	Le support éle	ctronique de données est joint			
	séquences su	n de conformité de la liste de ur support papier avec le ronique de données est jointe			
		utilisé l'imprimé «Suite», rombre de pages jointes			
	OU DU MANI (Nom et qua SAINT-(Pouvoir	DU DEMANDEUR DATAIRE lité du signataire) GOBAIN RECHERCHE N°422-5/S.006 : JAMET	(VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

SUBSTRAT TRANSPARENT UTILISABLE ALTERNATIVEMENT OU CUMULATIVEMENT POUR LE CONTRÔLE THERMIQUE, LE BLINDAGE ELECTROMAGNETIQUE ET LE VITRAGE CHAUFFANT

5

10

15

La présente invention se rapporte au domaine des vitrages pouvant être utilisés alternativement ou cumulativement dans trois applications particulières : le contrôle thermique (antisolaire et isolation thermique), le blindage électromagnétique et le vitrage chauffant, tout en pouvant, de préférence, subir des opérations de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C (il peut notamment s'agir d'une trempe, d'un recuit ou d'un bombage).

Le contrôle thermique est la possibilité d'agir sur le rayonnement solaire et/ou le rayonnement infrarouge de grande longueur d'onde traversant un vitrage séparant un environnement extérieur d'un environnement intérieur, soit pour réfléchir le rayonnement solaire vers l'extérieur (vitrages « antisolaires » ou « de contrôle solaire »), soit pour réfléchir le rayonnement infrarouge de longueur d'onde supérieure à $5~\mu m$ vers l'intérieur (isolation thermique avec des vitrages appelés notamment « vitrages bas-émissifs »).

20

25

30

Le blindage électromagnétique est la possibilité d'annihiler, ou pour le moins de réduire, la propagation d'ondes électromagnétiques à travers un vitrage. Cette possibilité est souvent associée avec la possibilité d'agir sur le rayonnement infra-rouge traversant le vitrage. Cette application trouve un intérêt dans le domaine électronique, notamment pour la réalisation de fenêtres de blindage électromagnétique, encore appelées « filtres électromagnétiques », destinées par exemple à être disposées sur la face avant d'un écran de visualisation utilisant la technologie plasma.

Un vitrage chauffant est un vitrage dont la température peut s'élever lorsqu'il est soumis à un courant électrique. Ce type de vitrage trouve des applications dans l'automobile, voire dans le bâtiment, pour la réalisation de vitres qui permettent d'empêcher la formation, ou de supprimer, du givre ou de la buée, ou encore de supprimer la sensation de paroi froide à proximité du vitrage.

La présente invention se rapporte plus particulièrement un substrat transparent, notamment en verre, muni d'un empilement de couches minces comportant une

10

15

20

25

30

2

pluralité de couches fonctionnelles, ledit substrat pouvant être utilisé pour réaliser alternativement ou cumulativement du contrôle thermique, du blindage électromagnétique et du vitrage chauffant.

Il est connu de réaliser des empilements de couches minces pour opérer du contrôle thermique, et plus précisément du contrôle solaire, qui soient capables de conserver à la fois leurs propriétés thermiques et leurs propriétés optiques après traitement thermique, en minimisant toute apparition de défauts optiques; L'enjeu étant alors d'avoir ainsi des empilements de couches minces à performances optiques/thermiques fixes, qu'ils subissent ou non par la suite un ou des traitement(s) thermique(s).

Une première solution a été proposée dans la demande de brevet européen N° EP 718 250. Elle préconise d'utiliser au-dessus de la ou des couches fonctionnelles à base d'argent des couches-barrière à la diffusion de l'oxygène, notamment à base de nitrure de silicium, et de déposer directement les couches d'argent sur le revêtement diélectrique sous-jacent, sans interposition de couches de primage ou de couches métalliques de protection. Cette demande de brevet décrit notamment un empilement du type :

Substrat/Si₃N₄ ou AlN/ZnO/Ag/Nb/ZnO/Si₃N₄

Une seconde solution a été proposée dans la demande de brevet européen N° EP 847 965. Elle repose sur des empilements comprenant deux couches d'argent, et décrit l'utilisation à la fois d'une couche-barrière au-dessus des couches d'argent (comme précédemment) et d'une couche absorbante ou stabilisante, adjacente auxdites couches d'argent et permettant de les stabiliser.

Cette demande de brevet décrit notamment un empilement du type : $Substrat/SnO_2/ZnO/Ag1/Nb/Si_3N_4/ZnO/Ag2/Nb/SnO_2/Si_3N_4$

Dans les deux précédentes solutions, on remarque la présence de la couche métallique absorbante de « sur-bloqueur », en niobium en l'occurrence voire en titane, sur les couches d'argent, permettant d'éviter aux couches d'argent le contact avec une atmosphère réactive oxydante ou nitrurante lors du dépôt par pulvérisation réactive respectivement de la couche de SnO2 ou de la couche de Si₃N₄.

Une troisième solution a depuis été divulguée dans la demande internationale de brevet N° WO 03/01105. Elle propose de déposer la couche métallique absorbante de « bloqueur » non pas sur la (ou chaque) couche fonctionnelle, mais dessous, afin de

10

15

20

25

30

permettre de stabiliser la couche fonctionnelle pendant le traitement thermique et améliorer la qualité optique de l'empilement après traitement thermique.

Cette demande de brevet décrit notamment un empilement du type : Substrat/Si₃N₄/ZnO/Ti/Ag1/ZnO/Si₃N₄/ZnO/Ti/Ag2/ZnO/Si₃N₄

Toutefois, un tel empilement n'est pas utilisable pour réaliser un vitrage chauffant ou un vitrage de blindage électromagnétique car sa résistance est trop élevée.

L'art antérieur connaît en outre des empilements de couches minces sur substrat qui peuvent être utilisés pour opérer du contrôle thermique et du vitrage chauffant lorsque soumis à un courant électrique. La demande internationale de brevet N° WO 01/14136 divulgue ainsi un empilement bi-couches d'argent supportant un traitement thermique de trempe, qui peut être utilisé pour opérer du contrôle solaire et pour produire de la chaleur lorsque soumis à une courant électrique. Toutefois, la résistivité de cet empilement ne permet pas de réaliser du blindage électromagnétique car sa résistance par carré R_{\Box} ne peut être inférieure à 1,5 ohms par carré. De plus, cette forte résistance par carré oblige à utiliser une batterie présentant une forte tension à ses bornes (de l'ordre de 42 Volts, standard disponible sur le marché) pour pouvoir opérer un chauffage sur toute la hauteur du vitrage. En effet, par application de la formule $P(W) = U^2 (V^2)/(R_{\Box} \times h^2)$, si $R_{\Box} = 1,5$ Ohm par carré, pour arriver à $P = 600 \text{ W/m}^2$ (puissance dissipée estimée pour chauffer correctement) et pour obtenir une hauteur de chauffage h > 0,8 mètre, il faut U > 24 Volts.

Il est également connu de réaliser des empilements de couches minces pour opérer du blindage électromagnétique à l'aide d'un substrat doté d'un empilement de protection électromagnétique présentant une bonne protection électromagnétique, et permettant à un utilisateur de visualiser facilement l'affichage des images grâce à une transmittance lumineuse élevée associée à une réflectance faible.

Pour réaliser du blindage électromagnétique, l'art antérieur connaît aussi de la demande internationale de brevet N°WO 01/81262 un empilement notamment du type :

 $Substrat/Si_3N_4/ZnO/Ag1/Ti/Si_3N_4/ZnO/Ag2/Ti/ZnO/Si_3N_4$

Cet empilement peut supporter un traitement thermique de trempe ou de bombage. Toutefois, cet empilement ne permet pas d'obtenir une résistance par carré qui soit de beaucoup inférieure à 1,8 ohm par carré.

Les empilements à base de couche d'argent sont fabriqués dans des unités de fabrication très complexes.

L'inconvénient majeur de l'art antérieur réside dans le fait qu'il est impératif de procéder à des modifications majeures dans la ligne de production lorsque l'on souhaite utiliser la ligne de production pour fabriquer un empilement de couches minces sur substrat qui n'a pas la (ou les) même(s) application(s) que l'empilement précédemment fabriqué sur cette même ligne.

Cette opération dure en général plusieurs jours, est fastidieuse et engendre une perte d'argent très importante car on ne peut produire de vitrages pendant cette période de transition et de mise au point.

10

15

20

25

30

Le but de l'invention est alors de pallier ces inconvénients en proposant un empilement et un procédé de fabrication qui permettent d'obtenir un produit utilisable alternativement ou cumulativement pour réaliser du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

La présente invention propose ainsi un empilement particulier, défini en terme de composition des différentes couches et d'épaisseur, qui peut être utilisé pour toutes ces applications à la fois, mais également un type d'empilement, défini en terme de composition des différentes couches, de plages d'épaisseur et/ou de caractéristiques optiques, dans lequel certaines valeurs d'épaisseur permettent de favoriser l'utilisation pour une application donnée. Cet empilement est remarquable en ce qu'il présente une résistance par carré faible (résistance R_{\square} < 1,5,voire \leq 1,3 Ω par carré) tout en conservant sensiblement ses caractéristiques lorsqu'il est soumis à un traitement thermique du type bombage ou trempe.

Ainsi, grâce à ce type d'empilement selon l'invention, pour fabriquer des empilements destinés à une seule ou seulement deux applications spécifique(s), certain(s) paramètre(s) peu(ven)t être changé(s), tel que l'épaisseur de certaines couches, mais la composition reste globalement identique. Quelques heures suffisent ainsi pour modifier la ligne de production et passer de la fabrication d'un produit ayant une ou deux application(s) préférée(s) à un autre produit ayant une ou deux autre(s) application(s) préférée(s).

La présente invention a ainsi pour objet un substrat transparent, notamment en verre, muni d'un empilement de couches minces comportant une pluralité de couches fonctionnelles, caractérisé en ce que ledit empilement de couches minces comporte au moins trois couches fonctionnelles à base d'argent, en ce que ledit empilement présente

10

15

20

25

30

une résistance R_{\square} < 1,5, voire \leq 1,3 Ω par carré et en ce que ledit substrat peut subir au moins une opération de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C, afin de permettre de réaliser à l'aide du substrat alternativement ou cumulativement du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

Par « ledit substrat peut subir au moins une opération de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C », on entend le fait que le traitement ne dégrade pas la qualité optique et n'engendre pas l'apparition de piqûres visibles à l'œil nu et/ou de flou en transmission lors de la réalisation d'un bombage, d'une trempe ou d'un recuit à une température d'au moins 500°C.

Dans une première application pour la réalisation d'un vitrage automobile, le substrat selon l'invention présente une transmission lumineuse $T_L \ge 70$ % et une résistance $R_{\square} < 1.5$, voire ≤ 1.3 , voire mieux encore ≤ 1.2 Ω par carré.

Dans une deuxième application pour la réalisation d'un vitrage de bâtiment, le substrat transparent selon l'invention présente une transmission lumineuse $T_L \ge 40$ %, voire ≥ 50 % et lorsqu'il est associé avec au moins un autre substrat pour former un vitrage, ce vitrage présente une sélectivité ≥ 2 .

Il est rappelé ici que la sélectivité est définie par le rapport entre la transmission lumineuse (T_L) et le facteur solaire (FS), soit par T_L / FS, le facteur solaire représentant la somme de la transmission énergétique directe (T_E) du vitrage et de l'énergie absorbée par le vitrage et ré-émise vers l'intérieur du bâtiment.

Dans une troisième application pour la réalisation d'un vitrage de blindage électromagnétique, le substrat transparent selon l'invention présente une transmission lumineuse $T_L \ge 40$ %, voire ≥ 50 %, voire mieux encore ≥ 55 % et une résistance $R_{\square} \le 1,1$, voire ≤ 1 Ω par carré.

L'avantage majeur engendré par le fait que le substrat de blindage électromagnétique supporte un traitement thermique du type trempe ou autre est que ainsi, on peut utiliser un substrat plus léger. En outre, les expériences montrent qu'il est toujours plus pratique au niveau industriel d'utiliser un substrat revêtu d'un empilement qui supporte un traitement thermique plutôt que d'utiliser un substrat ayant subi un traitement thermique puis de déposer un empilement dessus.

Le substrat sur lequel est déposé l'empilement est, de préférence, en verre.

10

15

20

25

30

D'une manière habituelle, dans le cadre de la présente invention, l'empilement étant déposé sur le substrat, ce substrat réalise un niveau 0 et les couches déposées dessus réalisent des niveaux au-dessus que l'on peut numéroter dans un ordre croissant avec des nombres entiers pour les distinguer. Dans le présent document, la numérotation est uniquement utilisée pour distinguer les couches fonctionnelles et leur ordre de dépôt.

Par couche « supérieure » ou couche « inférieure », on entend une couche qui n'est pas forcément déposée respectivement strictement au-dessus ou en dessous de la couche fonctionnelle lors de la réalisation de l'empilement, une ou plusieurs couches pouvant être intercalées. Chaque couche fonctionnelle étant associée avec une ou plusieurs couche(s) déposée(s) en dessous ou au-dessus de la couche fonctionnelle dont la présence dans l'empilement se justifie par rapport à cette couche fonctionnelle, on peut dire que l'association couche fonctionnelle avec sa (ou ses) couche(s) sous-jacente(s) et/ou sus-jacente(s) réalise « un motif ».

Selon une variante de l'invention, le substrat comporte au moins quatre couches fonctionnelles à base d'argent.

L'épaisseur totale des couches fonctionnelles à base d'argent est, de préférence, supérieure ou égale à 25 nm et est comprise sensiblement entre 35 et 50 nm lorsque l'empilement comprend trois couches fonctionnelles et sensiblement entre 28 et 64 nm lorsque l'empilement comprend quatre couches fonctionnelles. Dans une variante, la somme des épaisseurs des couches d'argent est inférieure à 54nm.

Selon une variante de l'invention, le substrat comporte au moins trois motifs identiques de couches fonctionnelles, chaque couche fonctionnelle étant associée dans chaque motif fonctionnel à au moins une couche(s) sous-jacente(s) et/ou sus-jacente(s).

Selon une autre variante de l'invention, au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, est située entre au moins une couche diélectrique inférieure et une couche diélectrique supérieure, lesdites couches diélectriques étant, de préférence, à base de ZnO, éventuellement dopé à l'aluminium.

Selon une variante de l'invention, au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, comporte une couche supérieure à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux.

Selon une variante de l'invention, le substrat est directement revêtu d'une couche à base de Si_3N_4 , AlN ou à base d'un mélange des deux.

Selon une variante de l'invention, dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante supérieure

10

20

25

30

(appelée « sur-bloqueur »), de préférence à base de Ti, est située entre la couche fonctionnelle à base d'argent et au moins une couche diélectrique supérieure.

Selon une autre variante de l'invention, dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante inférieure (appelée « sous-bloqueur »), de préférence à base de Ti, est située entre au moins une couche diélectrique inférieure et la couche fonctionnelle à base d'argent.

La couche métallique absorbante supérieure ou inférieure peut également être constituée d'un métal ou d'un alliage à base de nickel, chrome, niobium, zirconium, tantale, ou aluminium.

Selon une variante de l'invention, au moins un motif fonctionnel, et de préférence chaque motif fonctionnel, présente la structure suivante : $ZnO/Ag/...ZnO/Si_3N_4$ et de préférence la structure suivante : $ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si_3N_4$.

Selon cette variante, les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement tri-couches sont, de préférence :

 $ZnO / Ag /... ZnO / Si_3N_4 \ et \ de \ préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si_3N_4$ $7 \ \grave{a} \ 15/10 \ \grave{a} \ 17/... 7 \ \grave{a} \ 15/25 \ \grave{a} \ 65, \ nm... \ 7 \ \grave{a} \ 15/10 \ \grave{a} \ 17/0, 2 \ \grave{a} \ 2/7 \ \grave{a} \ 15/25 \ \grave{a} \ 65 \ nm.$

Selon cette variante également, les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement quadri-couches sont, de préférence :

...

ZnO / Ag / . . . ZnO / Si $_3N_4$ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si $_3N_4$

7 à 15/7 à 15/...7 à 15/23 à 65, nm... 7 à 15/7 à 15/0,2 à 2/7 à 15/23 à 65 nm.

L'invention a également pour objet un procédé de fabrication d'un substrat transparent, notamment en verre, muni d'un empilement de couches minces comportant une pluralité de couches fonctionnelles, caractérisé en ce qu'au moins trois couches fonctionnelles à base d'argent sont déposées sur ledit substrat, en ce que ledit empilement présente une résistance $R_{\square} < 1,5$, voire $\leq 1,3$ Ω par carré et en ce que ledit substrat peut subir des opérations de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C, afin de permettre de réaliser alternativement ou cumulativement à l'aide du substrat du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

Selon une variante de l'invention, au moins quatre couches fonctionnelles à base d'argent sont déposées sur ledit substrat.

L'épaisseur totale des couches fonctionnelles à base d'argent déposées est, de préférence, supérieure ou égale à 25 nm et est comprise sensiblement entre 35 et 50 nm

10

15

20

25

30

lorsque l'empilement comprend trois couches fonctionnelles et sensiblement entre 28 et 64 nm lorsque l'empilement comprend quatre couches fonctionnelles.

Selon une variante de l'invention, au moins trois motifs identiques de couches fonctionnelles sont déposés sur ledit substrat, chaque couche fonctionnelle étant associée dans chaque motif fonctionnel à au moins une couche(s) sous-jacente(s) et/ou sus-jacente(s).

Selon une variante de l'invention, pour au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, au moins une couche diélectrique inférieure est déposée sous ladite couche fonctionnelle et une couche diélectrique supérieure est déposée sur ladite couche fonctionnelle, lesdites couches diélectriques étant, de préférence, à base de ZnO, éventuellement dopé à l'aluminium.

Selon une variante de l'invention, une couche supérieure à base de $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$, AlN ou à base d'un mélange des deux est déposée au-dessus d'au moins une couche fonctionnelle, et de préférence au-dessus de chaque couche fonctionnelle.

Selon une variante de l'invention, ledit substrat est directement revêtu d'une couche à base de Si_3N_4 , AlN ou à base d'un mélange des deux, déposée préalablement au dépôt de toutes les autres couches.

Selon une variante de l'invention, dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante supérieure, de préférence à base de Ti, est déposée au-dessus de la couche fonctionnelle à base d'argent et au-dessous d'au moins une couche diélectrique supérieure.

Selon une autre variante de l'invention, dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante inférieure, de préférence à base de Ti, est déposée au-dessus d'au moins une couche diélectrique inférieure et au-dessous de la couche fonctionnelle à base d'argent.

Selon une variante de l'invention, au moins un motif fonctionnel, et de préférence chaque motif fonctionnel, déposé présente la structure suivante : $ZnO/Ag/...ZnO/Si_3N_4$ et de préférence la structure suivante : $ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si_3N_4$.

Selon cette variante de l'invention, les épaisseurs des couches déposées constitutives dudit motif pour l'empilement tri-couches sont, de préférence :

ZnO / Ag /...ZnO / Si $_3$ N $_4$ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si $_3$ N $_4$ 7 à 15/10 à 17/...7 à 15/25 à 65, nm... 7 à 15/10 à 17/ 0,2 à 2/7 à 15/25 à 65 nm.

Selon cette variante de l'invention également, les épaisseurs des couches déposées constitutives dudit motif pour l'empilement quadri-couches sont, de préférence :

ZnO / Ag /...ZnO / Si₃N₄ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄

7 à 15/7 à 15/...7 à 15/23 à 65, nm... 7 à 15/7 à 15/0,2 à 2/7 à 15/23 à 65 nm.

ioi acpoi

Selon une variante de l'invention, le dépôt des motifs fonctionnels est opéré en passant plusieurs fois ledit substrat dans un dispositif unique de fabrication.

Selon cette variante de l'invention, lorsque ledit empilement comporte quatre couches fonctionnelles à base d'argent, le dépôt des motifs est, de préférence, opéré par paire en passant deux fois ledit substrat dans un dispositif unique de fabrication, selon des conditions de dépôt sensiblement identiques pour les deux passages.

Selon cette variante de l'invention également, les épaisseurs des couches déposées sont, de préférence, sensiblement identiques lors de chacun des deux passages.

L'invention a également pour objet un vitrage de contrôle thermique et/ou de blindage électromagnétique et/ou chauffant incorporant au moins un substrat selon l'invention.

L'invention a également pour objet l'utilisation du substrat selon l'invention pour réaliser alternativement ou cumulativement du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

20

25

30

15

5

10

Avantageusement, les économies réalisées par la mise en œuvre du procédé selon l'invention lors de la réalisation d'empilement selon l'invention sont énormes, car il n'est plus nécessaire d'arrêter la ligne de production pendant de longues journées lorsque l'on veut produire des empilements ayant une (ou plusieurs) application(s) différente(s). Quelques heures suffisent pour modifier les paramètres de production sur la ligne et obtenir un produit commercialisable ayant l'(ou les) application(s) souhaitée(s).

Avantageusement également, le substrat selon l'invention peut être utilisé pour réaliser des vitrages monolithiques, double ou triple vitrages, vitrages feuilletés, pour réaliser alternativement ou cumulativement du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

Ainsi, pour l'application automobile, il est possible de réaliser un vitrage feuilleté incorporant un substrat selon l'invention, ce vitrage réalisant à la fois ;

- du contrôle thermique (et plus précisément du contrôle solaire pour réfléchir vers l'extérieur du véhicule le rayonnement solaire),
- du blindage électromagnétique pour protéger l'intérieur du véhicule du rayonnement électromagnétique extérieur et
- du vitrage chauffant permettant de faire fondre du givre ou de vaporiser de la buée.

10

15

20

25

30

De même, pour l'application bâtiment, il est possible de réaliser un double vitrage incorporant un substrat selon l'invention, ce vitrage réalisant à la fois,

- du contrôle thermique (du contrôle solaire pour réfléchir vers l'extérieur de la pièce équipée du vitrage le rayonnement solaire et/ou de l'isolation thermique pour réfléchir vers l'intérieur de la pièce équipée du vitrage le rayonnement interne):
- du blindage électromagnétique pour protéger l'intérieur de la pièce équipée du vitrage du rayonnement électromagnétique extérieur, et
- du vitrage chauffant permettant de désembuer ou d'empêcher la formation de buée et d'empêcher la sensation de « paroi froide » à proximité du vitrage.

Avantageusement, ces vitrages incorporant un substrat selon l'invention présentent des couleurs en réflexion et en transmission esthétiquement acceptables.

La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description détaillée ci-après d'exemples de réalisation non limitatifs et des figures ci-jointes :

- La figure 1 illustre les valeurs de taux de réflexion lumineuse vers l'extérieur des exemples 11 et 13 en fonction de la longueur d'onde λ ;
- La figure 2 illustre les taux de transmission lumineuse, respectivement, de l'exemple 21 selon l'invention et de l'exemple comparatif 22 en fonction de la longueur d'onde λ , ainsi que la courbe de Parry-Moon de densité d'énergie solaire D en fonction de la longueur d'onde λ ;
- La figure 3 illustre les taux de transmission lumineuse, respectivement, de l'exemple 21 selon l'invention et de l'exemple comparatif 22 en fonction de la longueur d'onde λ , ainsi que la sensibilité de l'œil humain Y sur une échelle H normalisée;
- La figure 4 illustre les taux de transmission lumineuse, respectivement, des exemples 23 et 24 selon l'invention et de l'exemple comparatif 25 en fonction de la

longueur d'onde λ , ainsi que la courbe de Parry-Moon de densité d'énergie solaire D en fonction de la longueur d'onde λ ; et

• La figure 5 illustre un schéma d'assemblage d'un vitrage de blindage électromagnétique mettant en œuvre le substrat selon l'invention.

5

1- Exemples d'empilements pour des vitrages chauffant et plus particulièrement pour des pare-brise alimentés en 12 V

La puissance dissipée pour chauffer correctement est estimée généralement à 600 W/m^2 .

10

15

Or $P(W) = U^2 (V^2)/(R_0 \times h^2)$. Si U=12V, il faut $R_0 = 1$ Ohm par carré pour h = 50 cm; h correspondant à la hauteur de la « fenêtre » dans laquelle est réalisé le chauffage afin d'empêcher la formation de buée et/ou de givre (en pratique, la tension U est de 12 à 14 V, ce qui correspond à la tension aux bornes des batteries de la majorité des véhicules de locomotion actuellement produits; toutefois, cette tension pourrait être comprise entre 12 et 24 V).

Pour l'application automobile, un empilement présentant les caractéristiques suivantes (en feuilleté) peut être jugé satisfaisant :

- $R_{\square} \le 1,2$ Ohm par carré;
- Bonne qualité (pas de défauts perceptibles à l'œil nu) après bombage ;

20

25

- $T_L \ge 70\%$ et R_L limitée;
- Couleur en réflexion jugée esthétique (de préférence a* ≤0 et b* ≤0);
- durabilités mécanique et chimique satisfaisantes.

Les solutions à deux couches d'argent encapsulées dans des diélectriques ne permettent pas d'obtenir à la fois une $T_L \ge 70$ %, une résistance $R_{\Box} \le 1,2$ Ω par carré et une couleur acceptable.

Pour parvenir au résultat souhaité, il apparaît préférable :

- de positionner l'empilement de couches comportant les couches fonctionnelles en face 3 ; et
- de déposer plus de deux couches d'argent eu égard à l'épaisseur totale des couches d'argent nécessaire.

30

Des exemples de constitution d'empilements selon l'invention sont donnés ciaprès avec des empilements à trois couches fonctionnelles (exemples 11 et 12) et à

quatre couches fonctionnelles (exemple 14), les résultats ayant été mesurés après une opération de trempe à 620 °C pendant environ 8 min.

Exemple 11 selon l'invention, tri-couches:

Couches	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag1	ZnO	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag2	ZnO	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag3	ZnO	Si ₃ N ₄
Epaisseur	37	7	12,5	8	49	7	12,5	8	53	7	12,5	8	29
(nm)				!									

extérieur/verre (2,1mm)/PVB (0,76mm)/Ag3/Ag2/Ag1/verre (1,6mm)/habitacle

Exemple 12 selon l'invention, tri-couches: Même empilement que l'exemple 11 avec en outre un sur-bloqueur en titane au-dessus de chaque couche fonctionnelle (épaisseur de l'ordre de 0,5 nm à 1 nm)

Exemple 13, exemple comparatif bi-couches:

Couches	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag1	ZnO	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag2	ZnO	Si ₃ N ₄
Epaisseur (nm)	24	8	8	6	70	8	7	6	26

extérieur/verre (2,1mm)/PVB (0,76mm)/Ag3/Ag2/Ag1/verre (1,6mm)/habitacle avec en outre un sous-bloqueur en titane au-dessous de chaque couche fonctionnelle (épaisseur de l'ordre de 0,5 nm à 1 nm)

Caractéristiques techniques mesurées :

Exemple	R_{D}	T _L (%)	T _E (%)	R _L (%)	a*(Rext)	b*(Rext)	R _E (%)
1	(Ohm/□)			ext.			
11	1,09	70,4	30,4	12,1	-10,9	11,7	46,0
12	1,00	70,1	30,8	14,2	-9,3	7,9	46,1
13	4,60	76,1	46,1	17,8	-4,8	-1,9	29,8

La résistivité des empilements, calculée à partir de la résistance par carrée mesurée sans contact à l'aide d'un dispositif Nagy est de l'ordre de 4,2.10⁻⁶ Ohm.cm pour les exemples tri-couches selon l'invention 11 et 12, alors qu'elle est de l'ordre de 7.10⁻⁶ Ohm.cm pour l'exemple bi-couches comparatif 13.

Les exemples selon l'invention 11 et 12 sont relativement stables en terme de T_L , R_L et couleur.

Les valeurs de réflexion énergétique sont très élevées, ce qui était attendu au regard de l'épaisseur cumulée d'argent ($3\times12,75$ nm). Une excellente sélectivité (T_L/FS proche, voire supérieure à 2 pour un échantillon feuilleté) a été obtenue.

10

5

15

25

20

13
Exemple 14 selon l'invention, quadri-couches:

Si ₃ N ₄	ZnO	Agl	ZnO	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag2	ZnO	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag3	ZnO	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag4	ZnO	Si ₃ N ₄
30	8	7	7	57	8	7	8	58	8	7,5	7	50	8	7,5	7	23

extérieur/verre (2,1mm)/PVB (0,76mm)/Ag3/Ag2/Ag1/verre (1,6mm)/habitacle

Caractéristiques techniques mesurées :

5

10

15

20

25

30

Exemple	R_{0}	T _L (%)	T _E (%)	R _L (%)	a*(Rext)	b*(Rext)	R _E (%)
	(Ohm/□)			ext.			
14	1,4	70,1	38,9	11,3	6,1	-9,9	31,8

La résistivité des couches d'argent inclues dans les empilements tri-couches comportant des couches d'argent présentant une épaisseur d'environ 13 nm est étonnamment basse par rapport aux valeurs obtenues avec un empilement bi-couches comportant des couches d'argent présentant une épaisseur d'environ 8 à 9 nm.

La qualité optique des trois exemples selon l'invention après bombage est satisfaisante : il n'y a pas de flou ni de piqures de corrosion observable dans les conditions habituelles.

La durabilité chimique et mécanique des empilements est également très bonne.

2- Exemples d'empilements pour des vitrages de contrôle thermique, particulièrement de contrôle solaire pour le bâtiment

Les performances d'un produit de contrôle solaire sont évaluées à partir du critère de « sélectivité », c'est à dire le rapport entre la transmission lumineuse du vitrage (T_L) et le pourcentage d'énergie solaire pénétrant à l'intérieur du bâtiment (Facteur Solaire – F.S.). Afin d'obtenir la plus importante sélectivité possible, tout en gardant un bon niveau de transmission lumineuse (nécessaire pour le confort des occupants des locaux), il est important de chercher à obtenir un vitrage qui assurera une coupure en transmission aussi abrupte que possible entre le domaine visible et le domaine infrarouge et ainsi éviter la transmission de l'énergie contenue dans cette partie du spectre (courbe Parry-Moon; PM). Le spectre idéal d'un vitrage de contrôle solaire est donc une fonction créneau assurant la transmission dans le visible et coupant totalement dans l'infrarouge.

La définition d'empilements tri-couches et quadri-couches d'argent selon l'invention permet d'augmenter cette sélectivité. En effet, pour des épaisseurs d'argent et de diélectrique bien choisies, le spectre en transmission d'un vitrage comportant ce type d'empilement se rapproche d'une fonction créneau et permet donc, à niveau de transmission égal, d'augmenter sensiblement la sélectivité. Ceci peut être obtenu sans perdre la neutralité en couleur des vitrages, aussi bien en transmission qu'en réflexion.

Des exemples de constitution d'empilements sont donnés ci-après avec des empilements à trois couches fonctionnelles (exemples 21 et 23) et à quatre couches fonctionnelles (exemple 24), comparés avec des empilements à deux couches fonctionnelles (exemples 22 et 25), respectivement pour obtenir un niveau transmission de 50 % (exemples 21 et 22), et un niveau transmission de 60 % (exemples 23 à 25) et une sélectivité optimisée.

Tous ces exemples ont été réalisés selon le schéma suivant :

extérieur/verre (6 mm)/empilement/espace(15 mm)/verre (6 mm)/intérieur,

avec un espace rempli d'argon à 90 % et 10 % d'air sec et les résultats donnés
ci-après ont été mesurés après une opération de trempe à 620 °C pendant environ 8 min.

Exemples 21 tri-couches selon l'invention et 22 bi-couches comparatif présentant chacun une transmission lumineuse de 50 % (épaisseurs des couches en nm):

Ex	Verre	Si ₃ N ₄	ZnO	Agl	ZnO	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag2	ZnO	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag3	ZnO	Si ₃ N ₄
21	6 mm	35	10	16,2	10	55	10	16,2	10	55	10	16,2	10	33
22	6 mm	26	10	9,2	10	63	10	19	10	20				

Une couche de sur-bloqueur en Ti d'environ 1 nm d'épaisseur a en outre été positionnée juste au-dessus de chaque couche fonctionnelle.

Caractéristiques techniques mesurées :

	T _L (%)	λ _d (nm)	p _e (%)	R _{int} (%)	L*	a*	b*	R _{ext} (%)	L*	a*	b*	T _E (P.M. masse2)	T_L/T_E
Ex. 21	50,2	501	6,6	12,7	42,3	3,4	3,1	13,8	43,9	1,0	1,3	20,0	2,51
Ex.22	49,3	514	3,3	23,0	55,1	0,7	5,9	19,2	50,9	3,1	9,2	24,2	2,04

5

10

15

20

15

Exemples 23 tri-couches selon l'invention, 24 quadri-couches selon l'invention et 25 bi-couches comparatif présentant chacun une transmission lumineuse de 60 % (épaisseurs des couches en nm):

Ex	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag1	ZnO	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag2	ZnO	Si ₃ N ₄	ZnO	АдЗ	ZnO	Si ₃ N ₄	ZnO	Ag4	ZnO	Si ₃ N ₄
23	30	15	14	15	50	15	14	15	50	15	14	15	30				
24	24	15	12,5	15	52	15	12,5	15	52	15	12,5	15	52	15	12,5	15	24
25	25	10	9,5	15	52	15	17	15	17								

5 Une couche de sur-bloqueur en Ti d'environ 1 nm d'épaisseur a en outre été positionnée juste sur chaque couche fonctionnelle.

Caractéristiques techniques mesurées :

	T _L (%)	λ _d (nm)	p _e (%)	R _{int} (%)	L*	a*	b*	R _{ext} (%)	L*	a*	b*	T _E (P.M. masse2)	T_L/T_E
23	57,0	541	3,5	12,3	41,7	-0,9	-8,6	12,7	42,3	-2,6	-8,7	25,2	2,26
24	58,0	537	2,9	12,6	42,2	-6,6	0,7	12,2	41,5	-4,5	-1,7	24,8	2,34
25	60,1	515	3,2	19,0	50,7	2,1	1,3	15,7	46,6	-2,2	-9,8	29,5	2,04

10

15

20

25

La comparaison des spectres des exemples selon l'invention 21, 23 et 24 avec les exemples comparatifs 22 et 25 sur l'ensemble du spectre solaire, illustrée figures 2 à 4, montre bien que les empilements tri-couches permettent de se rapprocher de la fonction créneau (pente très abrupte de la chute de transmission vers 780 nm (fin du domaine visible, début du domaine infrarouge). Il en va de même pour les empilements quadri-couches. Par ailleurs, cette augmentation de la sélectivité n'est pas obtenue au détriment de la colorimétrie du vitrage, la couleur en réflexion extérieure du vitrage étant neutre (dans le système L*a*b*) a* et b* étant négatifs et de faible valeur absolue. De plus, la couleur en transmission n'a pas une plus grande pureté, ce qui permet aux occupants des locaux d'apprécier l'environnement extérieur en vraies couleurs. Ce dernier point est observable sur la figure 3 montrant la superposition des spectres des exemples 21 et 22 et de la sensibilité de l'œil humain. En effet, ce graphique montre que le filtre optique réalisé à l'aide de l'empilement de couches minces de l'exemple 21 est plus large, en terme de longueur d'onde, que la distribution de la sensibilité de l'œil humain.

3- Exemples d'empilements pour des vitrages de blindage électromagnétique et plus particulièrement pour des écrans plasma

La structure de l'empilement réalisé pour vérifier l'intérêt de l'invention pour 5 le blindage électromagnétique est la suivante :

substrat en verre clair (6mm)/empilement de couches minces présentant au moins trois couches fonctionnelles.

La trempe réalisée préalablement aux mesure a été provoquée par une trempe après une trempe du substrat muni de l'empilement à une température d'environ 620 °C pendant 5 min.

Exemple 31 selon l'invention, quadri-couches:

																Si_3N_4
22	15	12,5	10	48	15	12,5	10	43	15	12,5	10	48	15	12,5	10	22

avec en outre un sur-bloqueur en titane au-dessus de chaque couche fonctionnelle (épaisseur de l'ordre de 0,5 nm à 1nm)

Exemple 32 selon l'invention, quadri-couches:

S																	S13N4
	30	15	14	10	65	15	14	10	60	15	14	10	65	15	14	10	30

avec en outre un sur-bloqueur en titane au-dessus de chaque couche fonctionnelle (épaisseur de l'ordre de 0,5 nm à 1 nm)

Caractéristiques techniques mesurées après recuit :

E	Exemple	R_{\square} (Ohm/ \square)	résistivité	T _L (%)	R _L (%)	λ _d (nm)	p _e (%)
	~	_ ,	$(10^{-6} \Omega.cm)$				
Г	31	0,9	4,5	72	6	490	9
Г	32	0,7	3,9	70	10	450	50_

Il apparaît que la trempe entraîne une baisse de la résistivité de l'argent (vraisemblablement par amélioration de la cristallisation de l'argent) et entraîne une modification très limitée des propriétés optiques de l'empilement (due vraisemblablement à l'oxydation du bloqueur et à la cristallisation de l'argent). En effet, pour l'exemple 31, la résistance de cet empilement avant recuit était $R_{\square} = 1, 1\Omega/\square$ (soit une résistivité de 5,5.10⁻⁶ Ohm.cm) et pour l'exemple 32, la résistance de cet

15

20

25

10

empilement avant recuit était $R_{\square}=0.9\Omega/\square$ (soit une résistivité de $5.0.10^{-6}$ Ohm.cm). Toutefois, la trempe n'entraîne pas de modification majeure de la couleur.

L'empilement selon l'invention peut être utilisé dans un assemblage présentant par exemple la structure illustrée figure 5, afin de réaliser un filtre électromagnétique pour un écran utilisant la technologie plasma. Cet assemblage comporte :

- 1- Une couche anti-reflet optionnelle;
- 2- Un substrat en verre clair, qui pourrait également être teinté;
- 3- Un empilement de couches minces présentant au moins trois couches fonctionnelles;
- 4- Une feuille de matière plastique en PVB, qui pourrait également être en PSA optionnelle;
- 5- Un film PET optionnel.

5

10

L'empilement de couches minces est ainsi positionné en face deux de 15 l'assemblage.

Le substrat recevant l'empilement peut être trempé après le dépôt de l'empilement.

La présente invention est décrite dans ce qui précède à titre d'exemple. Il est entendu que l'homme du métier est à même de réaliser différentes variantes de l'invention sans pour autant sortir du cadre du brevet tel que défini par les revendications.

15

20

25

30

18 REVENDICATIONS

- 1. Substrat transparent, notamment en verre, muni d'un empilement de couches minces comportant une pluralité de couches fonctionnelles, caractérisé en ce que ledit empilement de couches minces comporte au moins trois couches fonctionnelles à base d'argent, en ce que ledit empilement présente une résistance $R_{\rm O}$ < 1,5 Ω par carré et en ce que ledit substrat peut subir au moins une opération de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C.
- 10 2. Substrat transparent selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente une transmission lumineuse $T_L \ge 70$ %.
 - 3. Substrat transparent selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente une transmission lumineuse $T_L \ge 40$ % et en ce que lorsqu'il est associé avec au moins un autre substrat pour former un vitrage, ce vitrage présente une sélectivité ≥ 2 .
 - 4. Substrat transparent selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente une transmission lumineuse $T_L \ge 40$ % et une résistance $R_{\square} \le 1,1$ Ω par carré.
 - 5. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte au moins quatre couches fonctionnelles à base d'argent.
 - 6. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'épaisseur totale des couches fonctionnelles à base d'argent est supérieure ou égale à 25 nm et est de préférence comprise entre 35 et 50 nm lorsque l'empilement comprend trois couches fonctionnelles et entre 28 et 60 nm lorsque l'empilement comprend quatre couches fonctionnelles.
 - 7. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte au moins trois motifs identiques de couches fonctionnelles, chaque couche fonctionnelle étant associée dans chaque motif fonctionnel à au moins une couche(s) sous-jacente(s) et/ou sus-jacente(s).
 - 8. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, est située entre au moins une couche diélectrique

10000 10 00/07/07

5

15

20

25

30

18 REVENDICATIONS

- 1. Substrat transparent, notamment en verre, muni d'un empilement de couches minces comportant une pluralité de couches fonctionnelles, caractérisé en ce que ledit empilement de couches minces comporte au moins trois couches fonctionnelles à base d'argent, en ce que ledit empilement présente une résistance R_{\square} < 1,5 Ω par carré et en ce que ledit substrat peut subir au moins une opération de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C.
- 10 2. Substrat transparent selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente une transmission lumineuse $T_L \ge 70$ %.
 - 3. Substrat transparent selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente une transmission lumineuse $T_L \ge 40$ % et en ce que lorsqu'il est associé avec au moins un autre substrat pour former un vitrage, ce vitrage présente une sélectivité \ge 2.
 - 4. Substrat transparent selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente une transmission lumineuse $T_L \ge 40$ % et une résistance $R_D \le 1,1$ Ω par carré.
 - 5. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte au moins quatre couches fonctionnelles à base d'argent.
 - 6. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'épaisseur totale des couches fonctionnelles à base d'argent est supérieure ou égale à 25 nm et est de préférence comprise entre 35 et 50 nm lorsque l'empilement comprend trois couches fonctionnelles et entre 28 et 64 nm lorsque l'empilement comprend quatre couches fonctionnelles.
 - 7. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte au moins trois motifs identiques de couches fonctionnelles, chaque couche fonctionnelle étant associée dans chaque motif fonctionnel à au moins une couche(s) sous-jacente(s) et/ou sus-jacente(s).
 - 8. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, est située entre au moins une couche diélectrique

10

15

20

30

inférieure et une couche diélectrique supérieure, lesdites couches diélectriques étant, de préférence, à base de ZnO, éventuellement dopé à l'aluminium.

- 9. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, comporte une couche supérieure à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux.
- 10. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est directement revêtu d'une couche à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux.
- 11. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante supérieure, de préférence à base de Ti, est située entre la couche fonctionnelle à base d'argent et au moins une couche diélectrique supérieure.
- 12. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante inférieure, de préférence à base de Ti, est située entre au moins une couche diélectrique inférieure et la couche fonctionnelle à base d'argent.
- 13. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins un motif fonctionnel, et de préférence chaque motif fonctionnel, présente la structure suivante : ZnO/Ag/...ZnO/Si₃N₄ et de préférence la structure suivante : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄.
- 14. Substrat transparent selon la revendication précédente, caractérisé en ce 25 que les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement tri-couches sont :

ZnO / Ag /...ZnO / Si₃N₄ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄ 7 à 15/10 à 17/...7 à 15/25 à 65, nm... 7 à 15/10 à 17/0,2 à 2/7 à 15/25 à 65 nm.

15. Substrat transparent selon la revendication 13, caractérisé en ce que les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement quadri-couches sont :

ZnO / Ag /...ZnO / Si $_3$ N $_4$ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si $_3$ N $_4$ 7 à 15/7 à 15/...7 à 15/23 à 65, nm... 7 à 15/7 à 15/0,2 à 2/7 à 15/23 à 65 nm.

10

15

20

inférieure et une couche diélectrique supérieure, les dites couches diélectriques étant, de préférence, à base de ZnO, éventuellement dopé à l'aluminium.

- 9. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, comporte une couche supérieure à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux.
- 10. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est directement revêtu d'une couche à base de Si₃N₄. AlN ou à base d'un mélange des deux.
- 11. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante supérieure, de préférence à base de Ti, est située entre la couche fonctionnelle à base d'argent et au moins une couche diélectrique supérieure.
- 12. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante inférieure, de préférence à base de Ti, est située entre au moins une couche diélectrique inférieure et la couche fonctionnelle à base d'argent.
- 13. Substrat transparent selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins un motif fonctionnel, et de préférence chaque motif fonctionnel, présente la structure suivante : ZnO/Ag/...ZnO/Si₃N₄ et de préférence la structure suivante : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄.
- 14. Substrat transparent selon la revendication précédente, caractérisé en ce 25 que les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement tri-couches sont :

ZnO / Ag /...ZnO / Si₃N₄ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄ 7 à 15/10 à 17/...7 à 15/25 à 65, nm... 7 à 15/10 à 17/ 0,2 à 2/7 à 15/25 à 65 nm.

15. Substrat transparent selon la revendication 13, caractérisé en ce que les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement quadri-couches sont:

ZnO / Ag /...ZnO / Si $_3$ N $_4$ et de préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si $_3$ N $_4$ 7 à 15/7 à 15/...7 à 15/23 à 65, nm... 7 à 15/7 à 15/0,2 à 2/7 à 15/23 à 65 nm.

10

15

20

25

30

- 16. Procédé de fabrication d'un substrat transparent, notamment en verre, muni d'un empilement de couches minces comportant une pluralité de couches fonctionnelles, caractérisé en ce qu'au moins trois couches fonctionnelles à base d'argent sont déposées sur ledit substrat, en ce que ledit empilement présente une résistance $R_{\square} < 1.5 \Omega$ par carré et en ce que ledit substrat peut subir des opérations de transformation impliquant un traitement thermique à une température d'au moins 500°C.
- 17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce qu'au moins quatre couches fonctionnelles à base d'argent sont déposées sur ledit substrat.
- 18. Procédé selon la revendication 16 ou la revendication 17, caractérisé en ce que l'épaisseur totale des couches fonctionnelles à base d'argent déposées est supérieure ou égale à 25 nm et est de préférence comprise entre 35 et 50 nm lorsque l'empilement comprend trois couches fonctionnelles et entre 28 et 64 nm lorsque l'empilement comprend quatre couches fonctionnelles.
- 19. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 18, caractérisé en ce qu'au moins trois motifs identiques de couches fonctionnelles sont déposés sur ledit substrat, chaque couche fonctionnelle étant associée dans chaque motif fonctionnel à au moins une couche(s) sous-jacente(s) et/ou sus-jacente(s).
- 20. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 19, caractérisé en ce que pour au moins une couche fonctionnelle, et de préférence chaque couche fonctionnelle, au moins une couche diélectrique inférieure est déposée sous ladite couche fonctionnelle et une couche diélectrique supérieure est déposée sur ladite couche fonctionnelle, lesdites couches diélectriques étant, de préférence, à base de ZnO, éventuellement dopé à l'aluminium.
- 21. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 20, caractérisé en ce qu'une couche supérieure à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux est déposée au-dessus d'au moins une couche fonctionnelle, et de préférence au-dessus de chaque couche fonctionnelle.
- 22. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 21, caractérisé en ce que ledit substrat est directement revêtu d'une couche à base de Si₃N₄, AlN ou à base d'un mélange des deux.
- 23. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 22, caractérisé en ce que dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante supérieure, de préférence à base de Ti,

10

20

25

est déposée au-dessus de la couche fonctionnelle à base d'argent et au-dessous d'au moins une couche diélectrique supérieure.

- 24. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 22, caractérisé en ce que dans un motif fonctionnel au moins, et de préférence dans chaque motif fonctionnel, une couche métallique absorbante inférieure, de préférence à base de Ti, est déposée au-dessus d'au moins une couche diélectrique inférieure et au-dessous de la couche fonctionnelle à base d'argent.
- 25. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 24, caractérisé en ce qu'au moins un motif fonctionnel, et de préférence chaque motif fonctionnel, déposé présente la structure suivante : ZnO/Ag/...ZnO/Si₃N₄ et de préférence la structure suivante : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si₃N₄.
- 26. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement tri-couches sont : $ZnO \,/\, Ag \,/ ... ZnO \,/\, Si_3N_4 \ et \ de \ préférence : ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si_3N_4$
- 7 à 15/10 à 17/...7 à 15/25 à 65, nm... 7 à 15/10 à 17/ 0,2 à 2/7 à 15/25 à 65 nm.
 - 27. Procédé selon la revendication 25, caractérisé en ce que les épaisseurs des couches constitutives dudit motif pour l'empilement quadri-couches sont : $ZnO / Ag / ... ZnO / Si_3N_4$ et de préférence : $ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si_3N_4$ 7 à 15/7 à 15/23 à 65, nm... 7 à 15/7 à 15/0,2 à 2/7 à 15/23 à 65 nm.
 - 28. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 à 27, caractérisé en ce que le dépôt des motifs fonctionnels est opéré en passant plusieurs fois ledit substrat dans un dispositif unique de fabrication.
 - 29. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que lorsque ledit empilement comporte quatre couches fonctionnelles à base d'argent, le dépôt des motifs est opéré par paire en passant deux fois ledit substrat dans un dispositif unique de fabrication.
 - 30. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les épaisseurs des couches déposées sont sensiblement identiques lors de chacun des deux passages.
- 31. Vitrage de contrôle thermique et/ou de blindage électromagnétique et/ou chauffant incorporant au moins un substrat selon l'une quelconque des revendications 1 à 15.

32. Utilisation du substrat selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, pour réaliser alternativement ou cumulativement du contrôle thermique et/ou du blindage électromagnétique et/ou du vitrage chauffant.

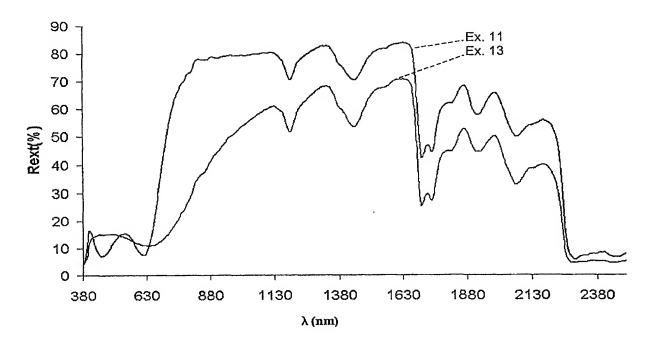


Fig. 1

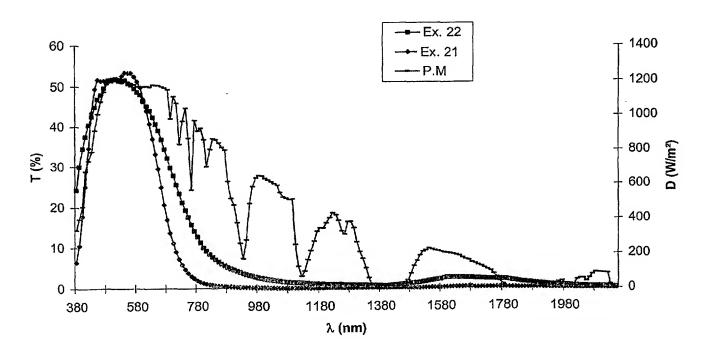


Fig. 2

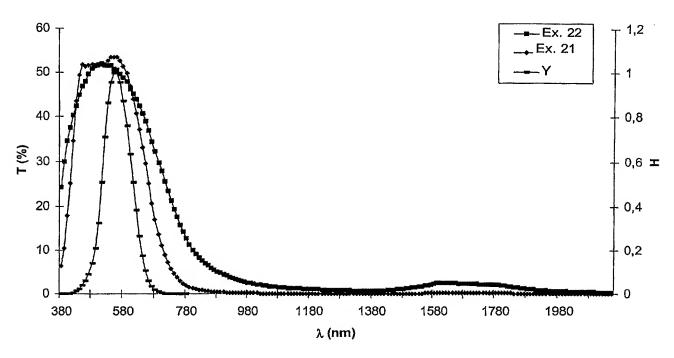


Fig. 3

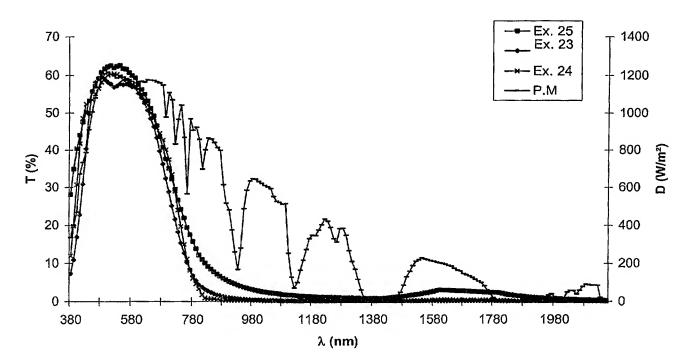
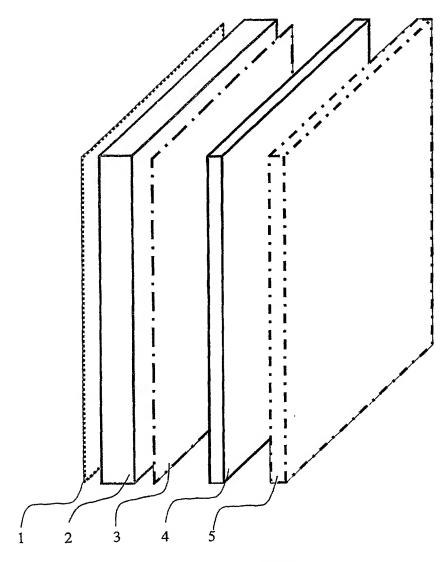


Fig. 4



<u>Fig. 5</u>



INPIPARIS 34 SP

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



11 FEV. 2004

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1..

BREVET D'INVENTION

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 113 W /260899 VJ2 2003103 FR Vos références pour ce dossier (facultatif) N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 03/13966

TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

SUBSTRAT TRANSPARENT UTILISABLE ALTERNATIVEMENT OU CUMULATIVEMENT POUR LE CONTROLE THERMIQUE, LE BLINDAGE ELECTROMAGNETIQUE ET LE VITRAGE CHAUFFANT.

LE(S) DEMANDEUR(S):

Vincent JAMET Pouvoir N°422-5/S.006

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE "Les Miroirs" 18 Avenue d'Alsace F-92400 COURBEVOIE **FRANCE**

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).

Nom		FLEURY	FLEURY			
Prénoms		Carinne	Carinne			
Adresse	Rue	SAINT-G	SAINT-GOBAIN RECHERCHE - 39 Quai Lucien Lefranc - FRANCE			
	Code postal et ville	93303	AUBERVILLIERS			
Société d'appartenance (facultatif)						
Nom		BELLIOT	BELLIOT			
Prénoms		Sylvain	Sylvain			
Adresse	Rue	SAINT-G	SAINT-GOBAIN RECHERCHE - 39 Quai Lucien Lefranc - FRANCE			
	Code postal et ville	93303	AUBERVILLIERS			
Société d'appa	rtenance (facultatif)					
Nom		NADAUI	NADAUD			
Prénoms		Nicolas	Nicolas			
Adresse	Rue	SAINT-G	SAINT-GOBAIN RECHERCHE - 39 Quai Lucien Lefranc - FRANCE			
	Code postal et ville	93303	AUBERVILLIERS			
Société d'appa	rtenance (facultatif)					
DATE ET SIGN DU (DES) DEI OU DU MAND (Nom et quali 11/02/2004	MANDEUR(S)					
1		ı				

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

PCT/FR2004/050614

